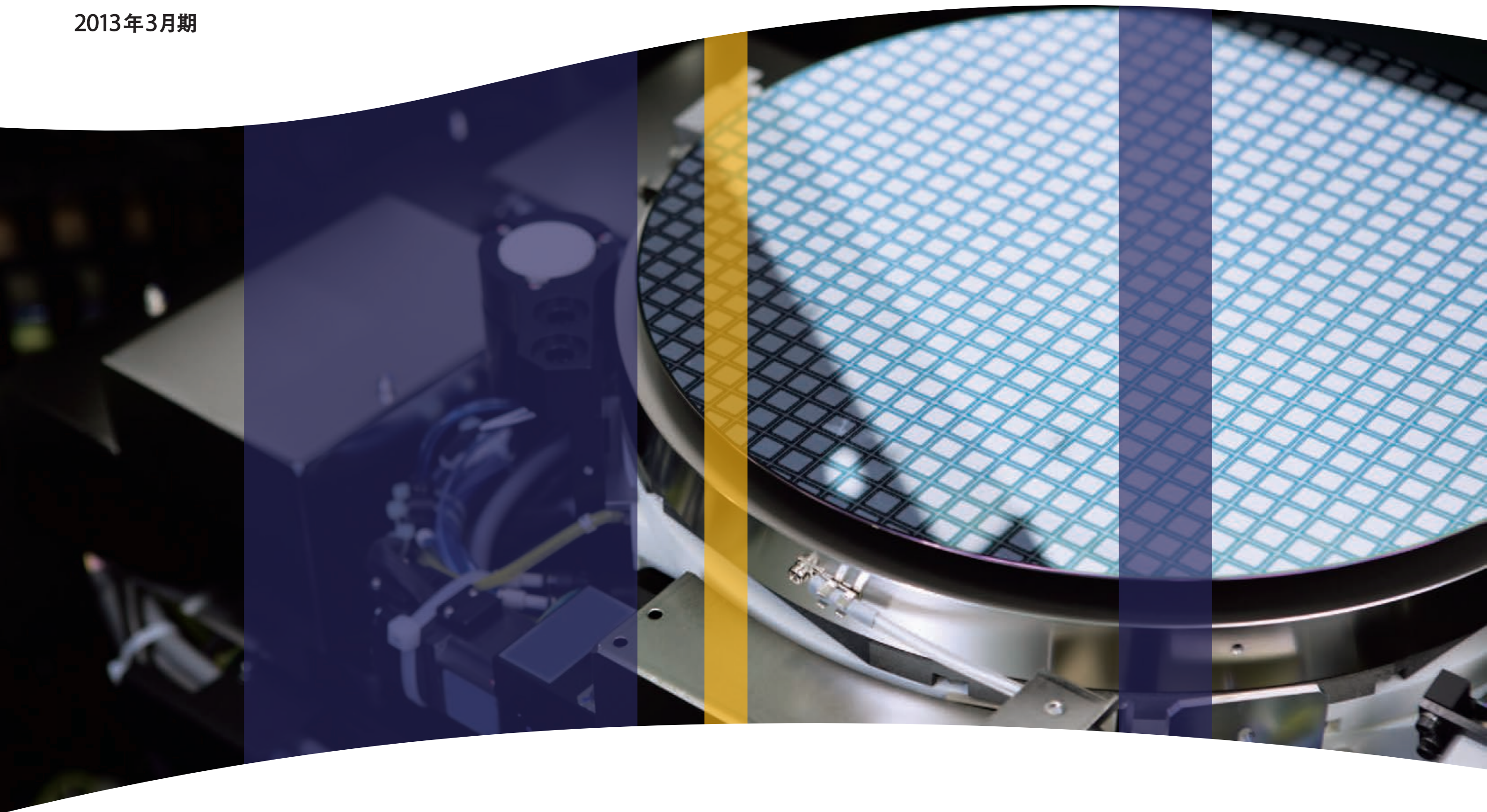


# アニュアルレポート 2013

2013年3月期



# 技術革新と顧客満足を追求し続けた半世紀

# 50th anniversary

東京エレクトロン(TEL™)は、2013年11月に創立50周年を迎えます。1963年の創業以来、常に時代の一步先を見据え、市場ニーズに応えるべく事業形態を変化させながら、先端エレクトロニクスの分野において技術革新をリードしてきました。本格的なモバイル・ビッグデータ時代を迎えた今、半導体は新たな成長期に入りつつあります。次の半世紀に向けて、当社は、技術開発を強化し、さらなる企業価値の向上を目指します。

## 創立50周年記念ロゴマークのご紹介

東京エレクトロンは、2013年11月11日に創立50周年を迎えるにあたり、創立50周年記念ロゴマークを制定いたしました。



### 夢のある未来社会へ向けて

このロゴマークは、東京エレクトロン創立50周年を機に、新たな未来へ向けた私たちの意思を表明するシンボルとして制定されました。私たちが標榜する「夢のある未来社会」のあり方を、「ひと」と「先端科学技術」と「環境・自然」が手を取り合い、ひとつの軸として動き出す姿によって象徴しています。このロゴマークをさまざまなTELのコミュニケーションの場、アプリケーションに活用していくことを通して、社員同士も手を取り合い、一丸となって未来社会に貢献していけることを願っています。

創業の時代、 技術商社としてスタート	ビジネスの大転換、 輸出ビジネスから撤退	メーカー機能を強化、 合併会社を次々と設立	自社生産の拡大、 世界のリーディング カンパニーへ	グローバル化の時代	生産革新	新たな成長への 挑戦
63 64 65 66 67 68 69 70	71 72 73 74 75 76	77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	87 88 89 90 91 92 93	94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08	09 10 11 12 13	

## Accelerating

## technology development

Technological innovation creates value for stakeholders

ICテストや電子部品など最先端の技術製品の輸入、カーラジオなど民生機器の輸出を手掛ける

1963  
創業



当時のカーラジオ

売上の6割を占めるカーラジオなどの民生機器の輸出から撤退

付加価値の高い半導体製造装置、コンピューター関連機器、電子部品の輸入に特化

1968

テル・サームコで拡散炉の国内生産開始



1964

半導体製造装置輸入事業に参入



サームコ社製拡散炉

海外メーカーとの合併事業の中から独自の製造技術を培うとともに、総合研究所を設立して研究開発機能を強化

1980

東京証券取引所市場第二部上場

1984

東京証券取引所市場第一部に指定替え

1986

総合研究所完成



1981

米国企業との合併会社を次々と設立し、商社機能に加えて最先端技術を持ったメーカーへと転換を図る



インサーキットボードテスタ



イオン注入装置

半導体製造装置メーカーとして現在の製品基盤を築く

1986-1987

新たに製造子会社を設立し、合併会社を再編するなどしてメーカー機能を強化



1990

液晶ディスプレイ製造装置事業に本格参入



プラズマエッチング装置

海外の販路開拓と技術サポートのために、拠点のグローバル展開を強力に推進

1996

Tokyo Electron America 新本社ビルおよびトレーニングセンターを開設



2007



東京エレクトロン九州新生産棟完成

2011



東京エレクトロン宮城新工場設立

2012

4件の企業買収を実施



2002



アルパニー・ナノテクノロジープログラムに参加

2009



TEL Technology Center, Taiwan

2012



テクノロジーセンターつくば

2012



TEL Technology Center, Korea



## 目次

## 連結財務ハイライト

3 連結財務ハイライト

## 事業概要

4 事業概要

## トップメッセージ

5 ステークホルダーの皆さまへ

6 CEOインタビュー

## 特集

9 特集: 成長を支える技術革新

10 特集1: 装置開発  
変化こそがビジネスチャンス —  
装置開発で先端を追求し続ける

特集2: 研究開発  
革新的な技術開発に果敢に挑戦

11 特集3: 外部技術の取得  
今が時機と捉えて行った  
成長戦略に基づく買収

12 特集4: ものづくり  
お客さまへ提供する価値を  
最大化するものづくり

## 部門別営業概況および事業展望

13 部門別営業概況および事業展望

## コーポレート・ガバナンス

14 コーポレート・ガバナンス

16 取締役、監査役および執行役員

## 環境・社会活動

17 環境・安全・健康に対する取り組み

## 知的財産

18 知的財産

## 財務セクション

19 財務概況

23 11年間の主要財務データ

24 連結貸借対照表

25 連結損益計算書

25 連結包括利益計算書

26 連結株主資本等変動計算書

26 連結キャッシュ・フロー計算書

27 連結財務諸表注記

35 独立監査人の監査報告書

## 会社情報

36 連結子会社 / 株式情報

## 将来見通しに関する注意事項

このアニュアルレポートで述べられている東京エレクトロンの将来の業績予測、経営戦略、確信等は、現時点で入手可能な情報に鑑みてなされた当社の判断に基づくものであり、これらの将来見通しの記述には、既知または未知のリスク、および不確実性等の要因が内在しています。従いまして、実際の業績、成果はここに述べられている見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

東京エレクトロンの将来見通しに直接的・間接的に影響を与える要因としては次のようなものがあります。

- 国内外の経済情勢、消費動向、為替相場の大幅な変動
  - 半導体/FPD/PV市況の変化
  - 半導体メーカー、FPDメーカー、太陽電池メーカー、電子機器メーカー等の東京エレクトロンの顧客が生産または提供する製品とサービスに対する需要の変化
  - 急速な技術革新、変化する顧客ニーズにタイムリーに対応する製品やサービスを東京エレクトロンが継続的に開発し提供していける能力
- 詳細につきましては、P22の事業等のリスクをご覧ください。

## アイコンの紹介

◀ 前のページへ

▶ 次のページへ

↶ 直前に開いたページへ戻る

CONTENTS 目次へ

🔍 PDF内の文字を検索

🖨️ 印刷

➕ 拡大

連結財務ハイライト

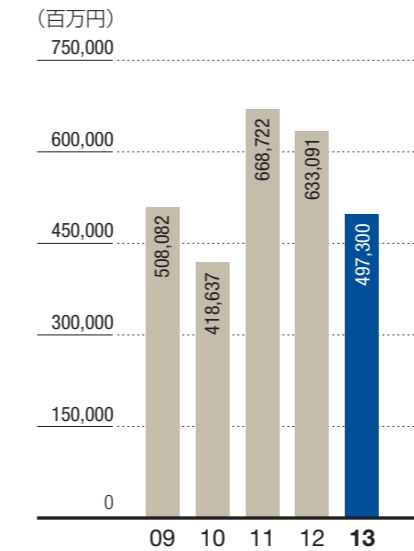
3月31日に終了した事業年度	百万円					千米ドル
	2009	2010	2011	2012	2013	2013
<b>会計年度:</b>						
売上高	¥508,082	¥418,637	¥668,722	¥633,091	<b>¥497,300</b>	<b>\$5,287,613</b>
営業利益(損失)	14,711	(2,181)	97,870	60,443	<b>12,549</b>	<b>133,429</b>
税金等調整前当期純利益(損失)	9,637	(7,768)	99,579	60,602	<b>17,767</b>	<b>188,910</b>
当期純利益(損失)	7,543	(9,033)	71,924	36,726	<b>6,076</b>	<b>64,604</b>
減価償却費	23,068	20,002	17,707	24,198	<b>26,631</b>	<b>283,158</b>
設備投資額	18,108	14,919	39,140	39,541	<b>21,774</b>	<b>231,515</b>
研究開発費	60,988	54,074	70,568	81,506	<b>73,249</b>	<b>778,830</b>
営業利益率	2.9%	(0.5)%	14.6%	9.5%	<b>2.5%</b>	
ROE	1.4%	(1.8)%	13.3%	6.3%	<b>1.0%</b>	

会計年度末:	百万円					千米ドル
	総資産	¥668,998	¥696,352	¥809,205	¥783,611	<b>¥775,528</b>
純資産	529,265	523,370	584,802	598,603	<b>605,127</b>	<b>6,434,099</b>

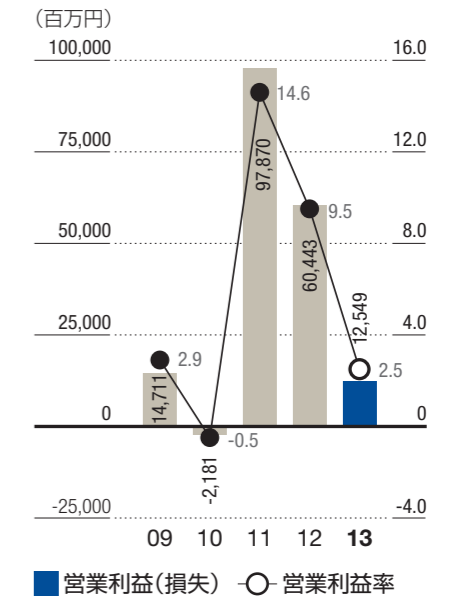
1株当たり情報:	円					米ドル
	当期純利益(損失)	¥ 42.15	¥ (50.47)	¥ 401.73	¥ 205.04	<b>¥ 33.91</b>
配当金	24.00	12.00	114.00	80.00	<b>51.00</b>	<b>0.54</b>

注記: 1. 米ドル表示は、2013年3月31日の為替レート1ドル=94.05円で換算しています。  
 2. 減価償却費には、のれん償却額および減損損失は含まれていません。

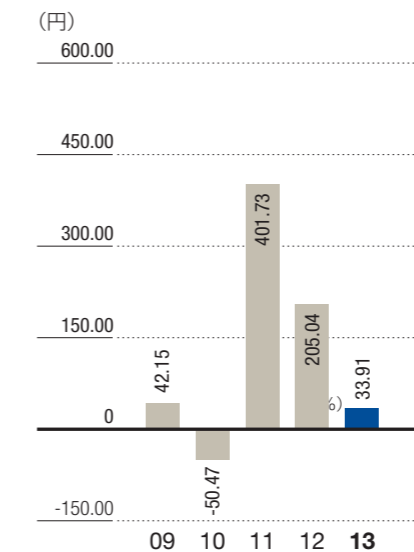
売上高



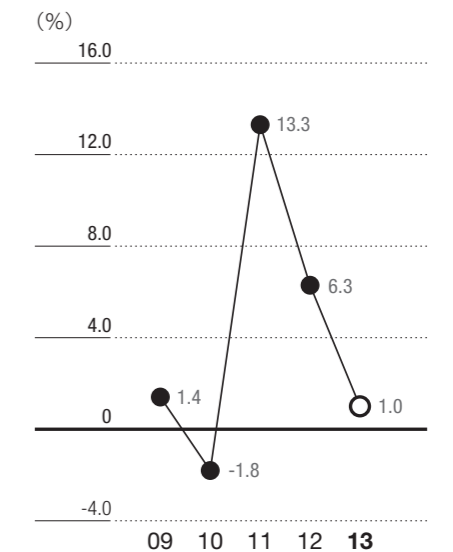
営業利益(損失)および営業利益率



1株当たり当期純利益(損失)



ROE



事業概要

事業概要

主要取り扱い製品

地域別売上構成比

半導体  
製造装置

スマートフォン、タブレットなどのモバイル機器をはじめ、薄型テレビなどのデジタル家電から最先端の医療機器に至るまで、あらゆる電子機器に使用されている半導体デバイス（ICチップ）。その生産を担う半導体製造装置を優れた技術サポートとともに提供しています。

ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置に加え、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバを取り揃えています。また、近年注目されている先端パッケージング工程に必要とされるTSVエッチング装置、電解めっき装置、ウェーハボンディング/デボンディング装置など新分野における製品ラインアップの拡充も進めています。

- コータ/デベロッパ
- プラズマエッチング装置
- 熱処理成膜装置
- 枚葉成膜装置
- 洗浄装置
- ウェーハプローバ



コータ/デベロッパ  
CLEAN TRACK™  
LITHIUS Pro™ Z



プラズマエッチング装置  
Tactras™



熱処理成膜装置  
TELINDY PLUS™



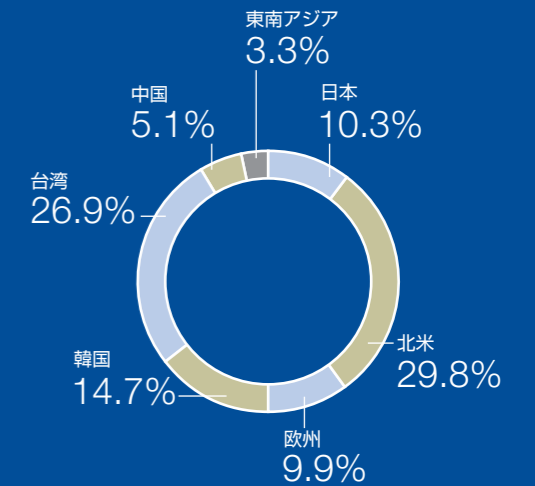
枚葉成膜装置  
Triasr™



枚葉洗浄装置  
CELLESTA™ -i



ウェーハプローバ  
Precio™



FPD/PV  
製造装置

フラットパネルディスプレイは、薄型テレビはもとより、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器、最近では広告媒体として使われるデジタルサイネージに至るまで、さまざまな場所で使用されています。その生産を担うFPDコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置を確かな技術サポートとともに提供しています。

太陽光発電は、中長期的に大きな成長が期待されています。当社は、サンベルト地域に代表される高温地域において製品優位性のある薄膜シリコン太陽光パネル用一貫製造ラインの提供を開始しました。

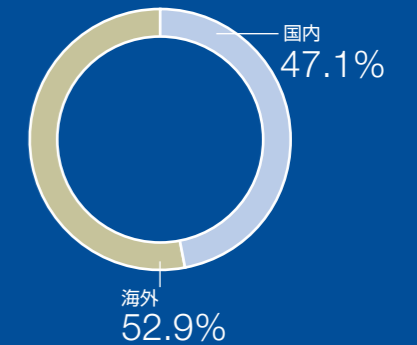
- FPDコータ/デベロッパ
- FPDプラズマエッチング/アッシング装置
- 薄膜シリコン太陽光パネル用製造装置



FPDコータ/デベロッパ  
Exceliner™



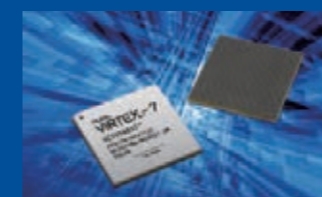
FPDプラズマエッチング/アッシング装置  
Impressio™



電子部品・  
情報通信機器

世界の優れた電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器などを多彩に取り揃え、販売を行う「商社ビジネス」と、顧客のニーズに応じて設計開発や自社ブランド商品の開発を行う「開発ビジネス」の二つの機能を有する、新しい形態のビジネスを展開しています。東京エレクトロンデバイス株式会社が当事業のオペレーションを行っています。

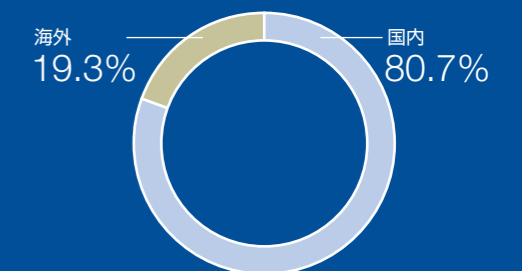
- 半導体製品
- 電子部品他
- ネットワーク・ストレージ機器
- ミドルウェア



Xilinx, Inc.  
FPGA



F5 Networks, Inc.  
ロードバランサ



## ステークホルダーの皆さまへ



## 半導体の進化を支える 技術変革を追求する

2013年11月、東京エレクトロンは創業50周年を迎えます。

はじめに、日頃より当社を支えてくださっているすべてのステークホルダーの皆さまに対して深く感謝申し上げたいと思います。

2013年3月期は、世界経済の全般的な停滞の影響を受け、当社が位置するエレクトロニクス産業においても、半導体メーカーの設備投資が大幅に減少しました。このような中、当社の業績は、売上高4,973億円、営業利益125億円、当期純利益61億円という結果となりました。配当に関しましては、長期にわたる皆さまのご支援に少しでもお応えするため、創立50周年の記念配当20円を加え、通期51円とさせていただきます。改めて御礼申し上げます。

さて、当社のお客さまである半導体メーカー、フラットパネルディスプレイメーカーの設備投資は長い抑制期間を経て、今年春より回復局面に転じ、当社製品に対する受注も活発化してきております。今後、本格的な上昇軌道に入るものと予測しております。その背景として、短期的には世界経済が回復しつつあることに加え、半導体の在庫調整が進んでいること、中長期的には本格的なグローバルネットワーク時代を迎え、クラウド・コンピューティングが普及していること、そして新型情報端末であるスマートフォンやタブレット型PCが、情報通信インフラの地殻変動を起こし、新興経済圏を含めた世界ベースで、網の目のようにその市場を広げていることが挙げられます。

これらグローバルネットワークを支えるシステムは、音声・画像を含めた膨大な量のデータを休むことなく受発信し、記憶するため、大量かつ高性

能の半導体の需要を喚起します。ネットワークが拡大・進化すればするほど、半導体を製造する装置に対する高性能および高生産性の要求が高まり、極めて高度な技術革新が必要となります。

東京エレクトロンは強い財務体質を基盤に、ネットワーク時代を根底から支える真のグローバル企業として、半導体の進化と量的拡大を支える技術革新に積極的に取り組んでまいります。

最後になりましたが、私このたび4月より改めて代表取締役社長を拝命いたし、会長職と兼務することとなりました。以下に掲げる経営方針を常に念頭におき、会社のさらなる成長とステークホルダーの皆さまのご期待に応えられるよう、一層の経営向上に努めていく所存です。

1. 技術革新が市場と利益を創造する経営を貫く
2. 顧客第一主義のもと、グローバルレベルで技術サポート力を強化する
3. 現場からトップまで創造性、挑戦意欲、情熱、責任感に満ちた活力のある会社づくりをする
4. ワールドクラスの高収益体質とさらなる成長を実現し、あらゆるステークホルダーの皆さまの期待に応える

皆さまの一層のご支援とご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2013年6月

代表取締役会長 兼 社長 CEO  
東 哲郎

## CEOインタビュー



## Accelerating technology development

Technological innovation creates value for stakeholders

**Q** 2013年3月期は、東京エレクトロンの事業戦略において、どのような位置付けの年でしたか？

**A** 2013年3月期は、低迷するマクロ経済の影響もあり、お客さまの設備投資が抑制されるなど、当社にとって厳しい事業環境となりました。その一方、中長期的には、半導体がさまざまな技術的な変革点を迎えつつあり、当社は、こうした新技術への移行をビジネス拡大の好機と捉え、自社開発の強化に加えて、大学やコンソーシアムとの共同開発の推進、企業買収による新技術の獲得など、将来の成長に向けた布石をこれまで以上に積極的に投じた一年でありました。

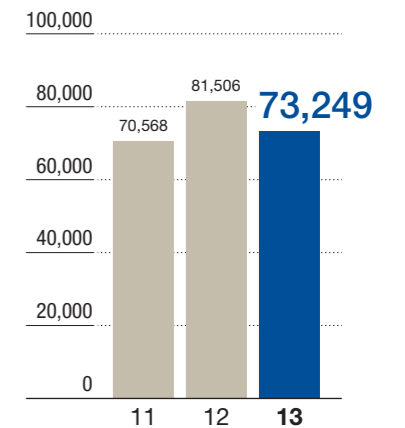
これまでも当社の収益の源泉は技術革新にあると申し上げてきました。2013年3月期においても、研究開発費を732億円と高位維持し、将来成長が期待され

るさまざまな分野において技術開発の一層の強化に努めました。また、近年、MRAM（磁気メモリ）などの新しい半導体デバイスの研究が活発化しています。こうした高度化する新半導体デバイスの製造には、既存の技術の延長線だけではなく、最先端の科学理論に基づく技術開発が以前にも増して重要となっており、東北大学をはじめとするアカデミアとの連携強化を図りました。半導体製造装置メーカーが、大学と連携して新しい半導体デバイスを生みだし、新しい製造装置を生みだしていくといった新たな市場創造に向けた取り組みが始まっています。加えて、550億円を投じて企業買収4件を実施し、優れた製品・技術を外部からも取り込みました。こうした多面的なアプローチにより技術革新を一段と加速させ、今後の東京エレクトロンの成長に繋げてまいります。

多面的なアプローチで技術革新を追求



研究開発費  
(百万円)



**Q** 東会長がCEOとなられて、今後の半導体製造装置市場の発展をどのように考えているのか改めてお聞かせください。また、発展の牽引力となるのは何でしょうか。

**A** 半導体に求められる技術は、より高度になり多様化しています。これには半導体製造装置の技術革新が不可欠で、我々製造装置の側からブレイクスルーを生みだしていくことが求められています。半導体が進化を続ける限り、製造装置サイドから付加価値の高い製品・ソリューションを提供し続けることで、半導体製造装置市場は、今後も拡大していくと確信しています。

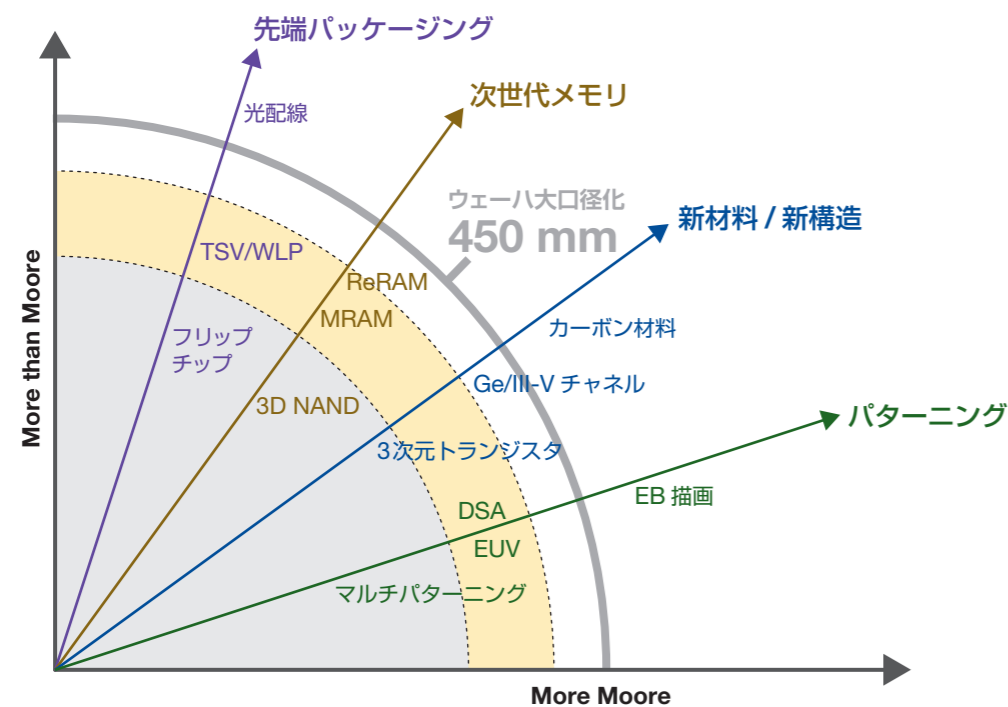
スマートフォン、タブレットをはじめとする先端モバイル機器の本格的な普及に加え、膨大なデータ通信を可能にするクラウド・コンピューティングの飛躍的な発展により、半導体需要は今後も拡大が見込まれています。また数量的な拡大と

CEOインタビュー

同時に、高速化・大容量化・低消費電力化など半導体デバイスに向けた技術的要求は高まる一方です。こうした要求に応えるために、いわゆるムーアの法則、従来のCMOSスケールに加え、さまざまな技術革新が起きつつあります（図1）。MRAM（磁気メモリ）などの次世代メモリをはじめ、3次元チップ積層技術などの次世代パッケージング技術に至るまで半導体を取り巻く技術革新に終わりはありません。

新しい半導体デバイスの創造においては、半導体製造装置メーカーの役割は従来にも増して重要となっており、今まで以上にさまざまな技術的課題を解決するソリューションを半導体製造装置の側から提供し、ブレイクスルーを生みだすことが求められています。こうした要求に応じていくことで半導体製造装置市場は、今後も中長期的に成長していくと確信しています。

図1: 多岐にわたる技術開発が半導体の進化を支え、半導体製造装置市場を牽引する



**Q** 昨年、半導体製造装置事業において企業買収を3件実施されましたが、その狙いをお聞かせください。

**A** 今回の買収は、いずれも将来技術の獲得を目指したものです。当社の製品・技術と補完し合い、技術開発を一気に加速させ、当社の成長を強固にするものと確信しています。

当社のコア事業である半導体製造装置（SPE）分野の強化のために、NEXX Systems、FSI International、Magnetic Solutionsの買収を実施いたしました。事業拡大を狙う洗浄装置事業における新しい枚葉洗浄技術の獲得、スマートフォン、タブレットの低消費電力化や高速化を可能にする先端パッケージング分野における製品ラインアップの拡充、さらにはDRAMやフラッシュメモリに続く次世代メモリとして有望なMRAM（磁気メモリ）の製造に欠かせない磁場中熱処理技術の獲得など、いずれの買収も新しい半導体デバイスの製造になくてはならない将来技術の獲得を目指したものです。

来たるべき市場拡大に向けて、優れた技術を外部からも取り入れ万全の準備をしています。



SPE 事業強化のための買収を実施

洗浄技術

FSI International, Inc.  
(現TEL FSI, Inc.)



先端パッケージング技術

NEXX Systems, Inc.  
(現TEL NEXX, Inc.)



MRAM 製造技術

Magnetic Solutions Ltd.  
(現TEL Magnetic Solutions Ltd.)





CEOインタビュー

**Q Oerlikon Solarを買収し、太陽光パネル製造装置ビジネスに参入する背景をお聞かせください。**

**A** 中長期的な観点で、東京エレクトロンの収益を拡大させていく新たな事業の柱にすることを旨とし、太陽光パネル製造装置市場への参入を決めました。大きな挑戦ですが、当社が長年培った半導体製造装置技術の強みを活かせる分野と考えます。

今後も太陽光発電が拡大していくには、太陽光発電の発電コストが、火力発電などの既存電力の発電コストよりも安くなることが求められています。当社は、Oerlikon Solarの持つ世界最先端の薄膜シリコン型太陽光パネルの技術をベースに、半導体製造装置、フラットパネルディスプレイ製造装置の独自技術を融合することで、発電コスト低減に繋がる装置開発の早期実現が可能であると考え、太陽光パネル製造装置市場へ参入しました。まずは技術の早期確立を目指すことに注力します。

**Q トップ交代により株主還元政策の考え方に変更はありますか？**

**A** 当面、当期純利益の35%を目途とする業績連動型の配当方針に変更はございませんが、経営環境および財務基盤を考慮し柔軟に判断していきます。

2013年3月期については、創立50年目を迎えたこともあり、日頃より当社をご支援くださっている株主の皆さまに感謝の意を表し、記念配当20円を加え、通

期で51円の配当とさせていただきます。また、2014年3月期においては、当社の安定的な財務基盤、昨今の世界経済の状況に鑑み、前期と同水準となる通期50円の配当を予定させていただいています。

今後も継続的な利益成長を通じて、企業価値の最大化と直接還元の向上を目指すとともに、自社株買いなどについては状況に応じて柔軟に判断し、株主還元の一層の向上に努めてまいります。

グローバル開発拠点

世界の主要顧客に密着した開発体制により技術革新を加速し、成長を通じて株主価値を最大化する



## 特集

## ■ 特集：成長を支える技術革新

## 特集：成長を支える技術革新

絶えず進化する半導体、その進化を支えているのが半導体製造装置です。  
東京エレクトロンは、次世代半導体デバイスに向けた独自技術の開発に加えて、最先端理論に基づく大学およびコンソーシアムとの共同開発や、優れた外部技術の取得により、技術革新を追求し続けます。

## TEL Technology Center, Korea

グローバルな開発体制の充実を目的として、国内、米国、台湾に続き、韓国にプロセス開発センターを設立しました。お客さまに密着した開発体制で、お客さまの求める製品を早期に市場投入していきます。



## テクノロジーセンターつくば

2012年4月に設立した「テクノロジーセンターつくば」では、半導体向け新材料や太陽光発電をテーマに研究開発を進めています。さらに、新しいシーズ技術を育成し、当社の将来を担う技術の確立を目指していきます。



## 企業買収

NEXX Systems社、FSI International社、Magnetic Solutions社 および Oerlikon Solar社の4件の買収を実施しました。半導体製造装置関連技術のみならず、独自の技術を応用した新たな事業分野への展開を図り、これからの成長ドライバーとする狙いです。



## 東京エレクトロンのものづくり

ものづくりには、「開発設計時に品質をつくり込む」フロントローディングが重要です。開発から製造までの一貫体制、新生産方式により、品質向上と生産性向上を実現します。



## 特集1：装置開発 / 特集2：研究開発

## 特集1：装置開発

変化こそがビジネスチャンス—  
装置開発で先端を追求し続ける

## 伊東 晃

取締役 専務執行役員  
SPE 事業担当  
SPE 営業統括本部長 兼  
ES BUGM

昨年はいまだ半導体市場を牽引してきたパソコンに代わり、スマートフォン、タブレットに代表される携帯端末が大きく伸びました。また、これらを支えるクラウドサービスが、サーバーやストレージ需要を喚起し、将来に向けて歴史的に大きな変化点であった年と考えています。

半導体デバイスに求められる高速化、省電力化は一層重要性を増しつつあり、半導体プロセス技術は、従来のリソグラフィを中心としたパターニング技術に加えて、3次元構造、材料、パッケージングなど、非常に多岐にわたって開発が進んでいます。当社では、こうした先端技術開発を、お客さまの拠点の近くで密着して行ってまいりました。

特に20nm以降で本格化する3次元構造 デバイスは、ロジックにおいては低ダメージ、高選択性が要求され、当社独自のRLSA™ エッチング技術、ドライ洗浄技術、また昨年買収したFSI International社のアッシングを不要とするウェット洗浄技術に高い関心と積

極的な評価をいただいております。メモリ分野も、NANDフラッシュにおいては積層構造の採用が見込まれており、DRAMトレンチプロセスで磨いた深堀エッチング技術や、パッケージング分野でもウェーハボンディング/デボンディング装置に代表されるウェーハ貼り合わせ技術が目立っています。

装置開発全般では、増大するプロセス工程に対し、生産性の改善も重要な課題です。当社の新製品であるALD成膜装置「NT333™」、コータ/デベロッパ「CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro™ Z」、枚葉洗浄装置「CELLESTA™-i」など、ほぼ全製品が前世代比1.5~2倍の生産性改善を達成、さらに450mm世代に向けて製品開発も進めています。

今後も、先端エレクトロニクスの製品サイクルが早まり、製造装置の開発スピードがますます重要になる中、お客さまをはじめ、大学、コンソーシアムとの協業をより深め、次世代技術に対応する製造装置をどこよりも早く提供することで時代のニーズに応えてまいります。

## 新技術に対応した製品開発で売上拡大を目指す



ALD成膜装置  
NT333™

従来のALD手法とは異なるコンセプトを用いたセミバッチ式のALD成膜装置。高生産性を維持しつつ、ナノスケール膜への対応を可能とする高品質な成膜を実現します。



コータ/デベロッパ  
CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro™ Z

スループット向上に加えて、ディフェクト低減への機能を付加してさらなる微細化に対応した塗付現像装置の最新モデル。



プラズマエッチング装置  
Tactras™ RLSA™ Etch

低ダメージ、高選択性を特徴とするシリコンエッチング装置。立体構造のトランジスタ形成工程で優位性を発揮します。

## 特集2：研究開発

## 革新的な技術開発に果敢に挑戦

半導体は、現在、微細化と消費電力の2つの壁に直面しています。成長を持続するために、この壁を打破する革新的技術を創出しなければなりません。

微細化を継続的に推進するために、次世代リソグラフィ技術として有望なEUV\*露光技術を世界のコンソーシアムと共同で開発しています。また、独自の成膜とエッチングを駆使するマルチパターニング技術で、最小寸法11nmを実現しました。一桁台も、もう目の前です。さらに、露光せずに物質の化学的特性を利用して回路パターンを形成するDSA\*\*技術も積極的に開発するなど、万全の技術開発を進めています。

消費電力の問題を解決する新技術は、新半導体材料を用いた動作電圧の低減と、DRAMやSRAMに代わり不揮発性メモリを導入することによる待機電力の削減です。

新半導体材料として、ゲルマニウム(Ge)やインジウムガリウム砒素(InGaAs)などのキャリア移動度の高い半導体の研究が進んでいます。シリコン基板上でのこれら異種半導体の集積化は、シリコン半導体デバイスの製造プロセスをすべてリセットするに等しい大変革です。この変化に対して東京エレクトロンは、従来の常識を越えた大胆なアイデアに基づく製造技術を開発しています。

また、ワーキングメモリを置き換えられる不揮発性メモリは、磁気メモリにおいて他にありません。極微細高集積磁

気メモリを実現する鍵は、磁性材料とそれを集積化する製造技術です。材料と一体になって製造技術を開発すべく、世界の最先端を走る東北大学との共同研究を通じて開発を加速しています。

さらに、当社は持続的社会的の実現に向けて環境・エネルギー問題にも取り組んでいます。クリーンエネルギーに貢献する薄膜シリコン太陽電池技術、また実用化が期待されている高輝度で低消費電力の有機ELパネル製造技術などの開発にも積極的に取り組んでいます。

東京エレクトロンは、この変化の激しい最先端技術分野で、革新的な技術開発に果敢に挑戦し続けています。

\* EUV: extreme ultraviolet  
\*\*DSA: directed self-assembly



## 保坂 重敏

常務執行役員  
コーポレート開発本部長



マルチパターニング技術により  
線幅11nmのパターンを実現



東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター 研究開発棟 2013年4月竣工

東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センターが実施する研究開発プログラムに参画し、次世代メモリとして注目されるMRAM(磁気メモリ)の製造装置技術の早期確立を目指しています。

特集3：外部技術の取得

特集3：外部技術の取得

今が時機と捉えて行った成長戦略に基づく買収

当社は2012年に4件のM&Aを完了しましたが、それぞれの背景には異なる目的がありました。第一は「既存事業の強化」です。米国FSI International社の買収は、当社の核である半導体製造装置事業において最重要課題のひとつである洗浄装置の競争力を即時に高めることが狙いであり、既にその効果が始まっています。また米国NEXX Systems社の買収により半導体パッケージングの製品ラインアップが拡充し、複雑化

する顧客ニーズに応えるソリューションを幅広く提供できるようになりました。第二は「次世代コア技術の獲得」です。アイルランドのベンチャー企業であるMagnetic Solutions社の買収により、将来期待されている新しいタイプの半導体メモリの製造に必須となるユニークな技術を取得しました。第三は「事業領域の拡大」です。スイスOerlikon Solar社の買収により当社は本格的に太陽光パネル製造装置事業に参入し、中

長期的には中核事業に育てる計画です。M&Aにより取得した新たなリソースと、当社の持つ独自技術・世界各国の拠点ネットワーク・営業サポート力などを融合し、計画どおり統合作業を進めて

います。当社の参入する事業分野は秒進分歩の速さで技術革新が進んでおり、差別化された優れた技術をタイムリーに開発・製品化し市場に投入することが求められます。今後も、広い視野で柔

軟にM&Aや協業を検討することで、事業の強化および成長に努め、収益貢献につなげてまいります。



**鷺野 憲治**  
取締役 専務執行役員  
コーポレート開発本部担当、  
ATS担当、FPD担当、PVE担当

成長を目指した買収

目的	取得技術	買収完了時期
<b>SPE事業の強化</b>	洗浄技術 ・枚葉洗浄装置  先端パッケージング技術 ・電解めっき装置 ・スパッタリング装置	FSI International, Inc. (現 TEL FSI, Inc.)  NEXX Systems Inc. (現 TEL NEXX, Inc.)
<b>SPE事業次世代コア技術の獲得</b>	MRAM 製造技術 ・磁場中熱処理装置	Magnetic Solutions Ltd. (現 TEL Magnetic solutions Ltd.)
<b>新規事業への進出</b>	太陽光パネル製造技術 ・薄膜シリコン太陽光パネル製造装置	Oerlikon Solar AG (現 TEL Solar AG)

FSI International社の買収

当社にない枚葉洗浄技術の補完で洗浄装置事業の拡大を狙う

従来からの製品ラインアップ

バッチ洗浄



枚葉洗浄



ドライ洗浄



物理洗浄



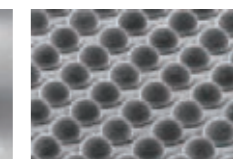
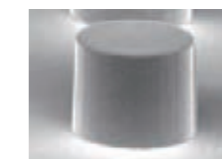
今後重要性を増す高温SPM(硫酸過水混合液)によるハイドーレジスト剥離装置を持つFSI International社の買収で、枚葉洗浄装置分野における競争力を強化していきます。

NEXX Systems社の買収

今後の成長ドライバーとなる先端パッケージング分野の製品ラインアップを強化する



Stratus 電解めっき装置



Cu pillar

Micro bump

TSV Cu埋め込み

先端パッケージング向け成膜装置(電解めっき装置、スパッタリング装置)メーカーであるNEXX Systems社の買収により、今後高成長が見込まれるTSV 3D積層技術向けの製品ラインアップが拡充されました。

TSV: through-silicon via

## 特集4：ものづくり

## 特集4：ものづくり

## お客さまへ提供する価値を最大化するものづくり

東京エレクトロンは、お客さまへ提供する価値を最大化するものづくりの実現を目指しています。一昨年には、エッチング装置の開発から製造までを一貫して行う東京エレクトロン宮城工場の稼働を開始しました。それに続き昨年は、フラットパネルディスプレイ (FPD) 製造装置の主な市場である中国において、FPD用エッチング装置の製造および重要部品の定期補修をする新工場の稼働を開始しました。

当社のものづくりの基本方針は、「開発設計時点で品質・コスト・製造工程をつくりあげ、市場要求に継続的に適応

できるものづくりの実現」です。広義の品質には、機能・安全・環境・信頼性・保全性・経済性といった要素が含まれます。ものづくりの原点は、お客さまが求めているもの、困っていることを、正確に理解すること (マーケティング) にあります。

半導体に求められている技術革新は、「低消費電力」「動作スピードの高速化」そして「低コスト」です。それらを実現するために必要なのが、微細化・新材料・新構造の適用、ウェーハの大口径化、そしてトータルコストリダクションであり、当社はこれらを可能とする機能

を製造装置に具備しなくてはなりません。そのためにはまず、先進技術や既存技術の組み合わせによって、差別化する技術をより早く生み出すことが求められます (価値の創出)。また、開発設計したものを、繰り返し最も低コストでつくるのが生産技術として求められます (価値の最大化)。さらには、製造装置の機能は、将来にわたって持続的な競争優位を築くための核となるコア技術・基盤技術に裏付けされていることが重要です (価値の源泉)。

お客さまが、生産設備として当社の装置に求める要件は、「良品をつくる条

件が明確で、容易に設定でき、また安定的に状態を再現でき、変化が事前にわかり、修復が容易であること」です。これらのことは、繰り返しになりますが、目指す品質を設計の段階からつくり込む必要があります。

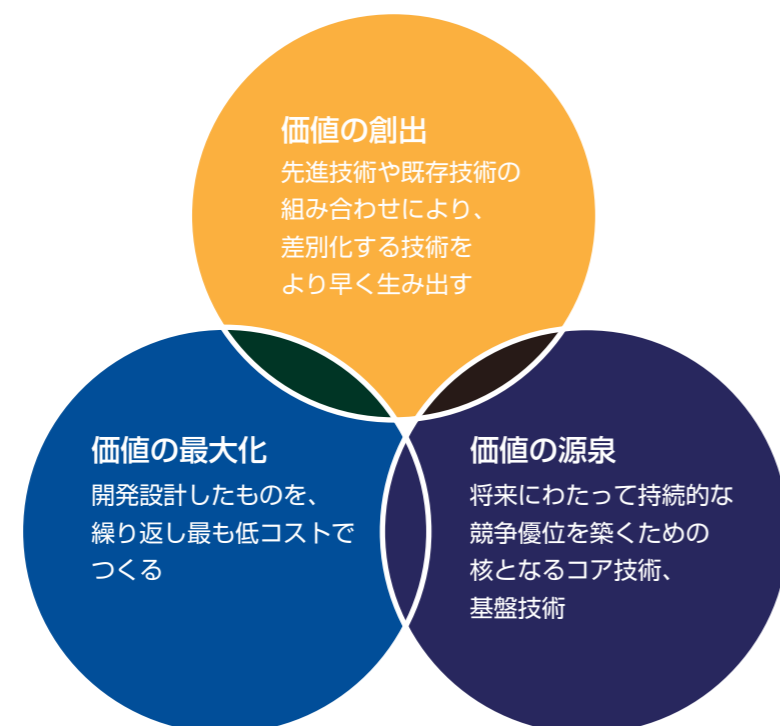
以上で述べましたように、ものづくりはマーケティングから始まり、品質を開発設計時点でつくり込むこと (フロントローディング) が重要であると思っております。また、短期間でこれを行うには、コンカレントエンジニアリング\*を実践しなくてはなりません。さらに、マーケティングから生産まで、

すべての工程において、TPM活動\*\*のムダとりと自工程保証に取り組むことが必要です。

今年当社は創立50周年を迎えます。次の50年に向けて、ものづくりのさらなる深化・進化に取り組みながら、メーカーとして成長し続けたいと考えます。

\* コンカレントエンジニアリング: 製品開発において概念設計/詳細設計/生産設計/生産準備など、各種設計および生産計画などの工程を同時並行的に行うこと

\*\* TPM活動: Total Productive Managementの略。製造のムダをなくし、生産効率化を目指す全員参加型の活動



## 中国昆山新工場、FPD用エッチング装置の製造を開始



東電光電半導体設備(昆山)有限公司

フラットパネルディスプレイ製造装置の主な市場である中国において、FPD用エッチング装置の製造を開始、お客さまへの対応力向上とコスト低減を目指します。



北山 博文

代表取締役副社長  
倫理担当、製造・技術担当、  
システム開発本部担当、IT担当  
生産本部長、品質担当

## 部門別営業概況および事業展望

## 売上高

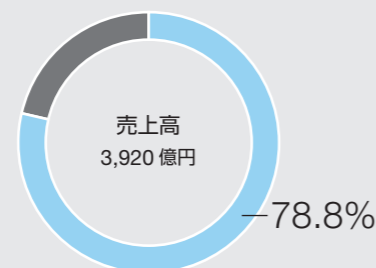
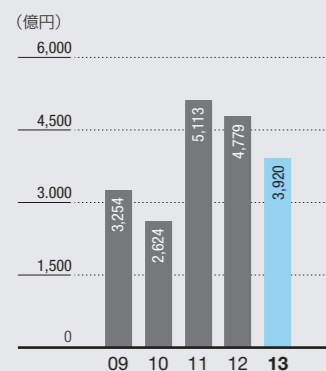
## 売上高構成比

## 事業環境

## 営業概況

## 事業展望

## 半導体製造装置



2013年3月期の世界半導体設備投資は、世界景気低迷の影響を受け、前年に引き続き調整局面が続きました。パソコン出荷の鈍化に起因するDRAMの需給バランス悪化に加え、NANDフラッシュメモリも期待されたほどには需要が伸びず、メモリ顧客における生産能力増強投資が控えられました。一方、モバイル機器、サーバー等に使用されるロジック系半導体に対する需要は強く、ロジック向け投資は堅調でした。

- 部門売上高：前年比18.0%減少の3,920億円
- メモリ投資低迷の影響で、国内向け51%の減少、韓国向け47%の減少
- 堅調なロジック投資を背景に、台湾向け40%の増加、米国向け2%の増加
- コータ/デベロッパの製品シェア、過去最高の89%を達成
- 注力するエッチング装置、洗浄装置分野で、顧客の新規量産ラインにおける認定を複数獲得
- 成膜分野において、ALD成膜装置、メタル成膜装置の新製品を市場投入

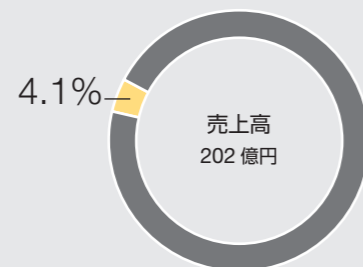
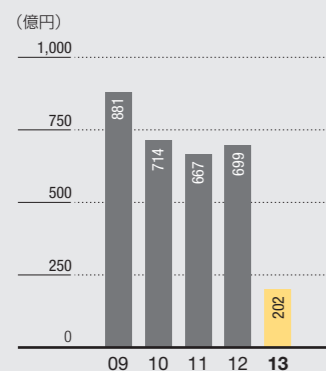
\*地域別売上構成についてはP4をご参照ください。

スマートフォン、タブレットをはじめとするモバイル機器の本格的な普及と、その膨大なデータ通信を可能にするクラウド・コンピューティングの発展により、今後も半導体の需要は拡大し続けると同時に、求められる技術革新はますます高度になり多様化していきます。

こうした半導体の量的拡大と高度な技術革新を実現していくために、半導体製造装置の果たす役割はますます重要となり、半導体設備投資を牽引してまいります。

当社は、こうした新技術への移行を事業拡大につなげるべく、積極的に新製品を投入してまいります。既に高い製品シェアを持つコータ/デベロッパについては、生産性の向上やEUV露光に対応した製品を投入し、成膜装置については、セミバッチ式のALD成膜装置やメタル成膜装置の新製品で収益拡大を狙います。注力分野として位置付けているエッチング装置と洗浄装置については、低ダメージと高選択性を特徴とするエッチング装置、先端ロジック向け枚葉洗浄装置、ドライ洗浄装置でシェア拡大を目指します。ウェーハプローバでは、顧客の生産コスト低減に寄与する新製品の投入で参入市場拡大を図ります。また、高い成長が見込まれるパッケージング分野においては、昨年企業買収した現TEL NEXX社の電解めっき装置をはじめ、充実した製品ラインアップにより売上拡大を目指します。

## FPD/PV製造装置



2013年3月期のフラットパネルディスプレイ (FPD) 設備投資は、先進国における薄型テレビの需要鈍化により大型パネル向け投資が先送りされ、モバイル機器に使用される高精細・中小型パネル向けの投資に限定されたため、前年比約70%の大幅な減少となりました。

太陽光パネル需要は世界全体で急拡大しています。設備投資については、2008年以降の過剰投資で生まれた競争力の低い生産ラインが淘汰される局面を迎えており、2012年を底に今後は増加に向かうのではないかと見られています。

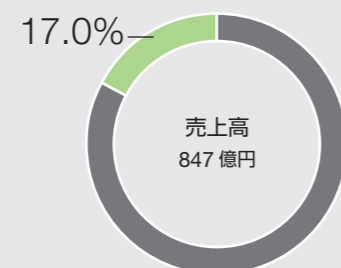
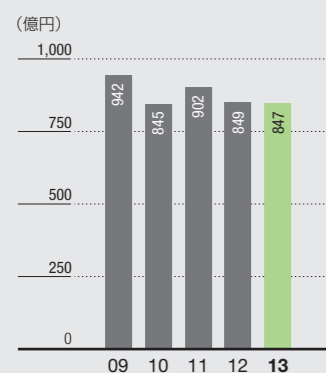
- 部門売上高：前年比71.2%減少の202億円 (FPD製造装置の売上がほぼ100%)
- FPD製造装置の世代別売上では、G6以下の中小型パネル向けが全体の約85%
- パネルの高精細化に対応するG8向け新型ICPエッチング装置を市場投入
- 中国昆山工場でFPDプラズマエッチング装置の補修および装置製造を開始

\*地域別売上構成についてはP4をご参照ください。

スマートフォン、タブレットなどのモバイル機器向けの中小型ディスプレイ市場は堅調に推移し、中国では大型パネル向け設備投資も再開されます。TFT基板には、従来のアモルファスシリコンに代わって、低温ポリシリコン (LTPS) や酸化物半導体 (IGZO) の採用が進んでいます。さらにポスト液晶として、より高画質で低消費電力の有機ELディスプレイが、既にモバイル向けに実用化されており、いよいよテレビ向けの大型有機ELディスプレイ製造への取り組みが加速してきました。当社はこうした技術革新が進行する中、新しいTFT技術に対応した競争力のある製品の投入、および有機EL成膜装置の新規市場参入により事業成長を目指します。また中国昆山工場での製造を本格化し、顧客対応力向上とコスト低減に取り組みます。

中長期的な観点で新たな事業の柱にするべく取り組んでいる太陽光パネル製造装置事業については、企業買収した現TEL Solar社の高い薄膜シリコン太陽光パネル製造技術をベースに、低コスト発電の鍵となる高変換効率の達成に向け、開発を強化してまいります。

## 電子部品・情報通信機器



2013年3月期の国内電子部品市場は、民生用電子機器、産業機器ともに低迷しました。また、IT投資においては、データセンターなどのクラウド・コンピューティング市場は拡大基調にありましたが、民間設備投資は厳しい状況が続きました。

- 部門売上高：前年比0.2%減少の847億円
- 半導体および電子デバイス事業の売上は、国内需要が民生用電子機器・産業機器ともに低水準で推移したことにより国内売上が約10%減少したが、中国をはじめ、アジア地域での売上が伸長したために、全体としては前年比0.7%減少
- コンピュータシステム関連事業の売上は、製品販売および保守ビジネスが堅調に推移したことにより、前年比2.2%増加

\*地域別売上構成についてはP4をご参照ください。

半導体および電子デバイス事業においては、今後もアジア地域の市場成長が持続することが見込まれます。また、コンピュータシステム関連事業においては、クラウド・コンピューティングの普及を背景にデータセンターへの投資が継続すると予想されます。

こうした市場動向を視野に、当事業部門では既存ビジネスや商権獲得による販路拡大に留まらず、海外現地企業への展開、自社ブランド製品inrevium™(インレビウム)の海外拡販などにより事業成長を目指してまいります。また、クラウド・コンピューティング、データセンター向けに直接販売体制を強化することに加え、高付加価値の新製品の投入や最適なソリューションの提供に邁進してまいります。

## コーポレート・ガバナンス

東京エレクトロンは、経営のグローバル化が進行する中、株主をはじめとする全てのステークホルダーにとっての企業価値の向上を重視した経営を推進するため、コーポレート・ガバナンスの強化が重要と考えています。当社は以下の3つの基本方針のもと、最適で実効性の高いガバナンス体制の構築に努め、内部統制システムおよびリスク管理システムの整備・強化を推進しています。

### 当社のコーポレート・ガバナンスの基本方針

1. 経営の透明性と健全性の確保
2. 迅速な意思決定と事業の効率的執行
3. タイムリーかつ適切な情報開示

### ■ コーポレート・ガバナンス体制

当社は会社法に基づく監査役会設置会社でありながら、より経営の透明性・客観性を高めるために、代表取締役を除く取締役または監査役でそれぞれ構成する、独自の報酬委員会<sup>\*1</sup>、指名委員会<sup>\*2</sup>を設置しています。また、取締役会と執行機関の役割をより明確化するために、2003年より執行役員制を導入し、意思決定の迅速化を図っています。加えて、株主に対する経営の透明性が重要であるとの視点に立ち、1999年より代表取締役の個別報酬を開示しています。

\*1 報酬委員会：役員報酬の制度および代表取締役の報酬額を取締役に提案する。  
\*2 指名委員会：取締役候補および最高経営責任者候補を指名し、取締役会に提案する。

### 取締役会

取締役11名（うち社外取締役2名）で取締役会を構成しています。取締役会は原則として月1回開催し、2013年3月期は合計12回の取締役会を開催しました。経営環境の変化に迅速に対応し、経営責任をより一層明確に示す体制とするため、当社の取締役の任期は1年です。

### 監査役会

監査役5名（うち社外監査役3名）で監査役会を構成しています。監査役は取締役会、経営会議等の重要な会議に出席するほか、業務監査、会計監査、リスク管理の評価を行うとともに、取締役の職務執行を監査しています。2013年3月期は合計7回の監査役会を開催しました。

### 社外取締役・社外監査役

当社は、取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、井上弘氏（(株)東京放送ホールディングス代表取締役会長）、坂根正弘氏（(株)小松製作所相談役・特別顧問）の2名を社外取締役として、また、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、赤石幹雄氏、山本高稔氏、酒井竜児氏（長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士）の3名を社外監査役として招聘しています。なお、赤石幹雄氏は、常勤監査役として当社グループの監査をしています。

### 役員報酬

当社は、業績や株主価値との連動性を高めるとともに、企業競争力強化および経営の透明性向上につなげることを目的とした役員報酬制度を採用しています。

1. 取締役の報酬は、月額固定報酬と年次業績連動報酬からなります。
2. 取締役の業績連動報酬制度につきましては、企業価値・株主価値向上に対する要素をより明確に報酬に連動させるため、評価指標として業績連動指標である連結当期純利益と連結自己資本当期純利益率「ROE」の達成度を加味することとし、当期の重点経営目標指標、特殊な損益および考慮すべき特殊要因等がある場合は必要な調整を行います。業績連動報酬は原則として現金賞与と株式報酬で構成し、その構成割合は概ね1対1としています。また、業績連動報酬額は年間固定報酬額の5倍を上限としています。株式報酬につきましては、「権利行使価額を1株につき1円に設定した新株予約権」を付与することとし、3年間の権利行使制限期間を設定しています。
3. 年次業績連動報酬において、社外取締役は株式報酬の支給対象外です。
4. 監査役の報酬は、監査役の経営に対する独立性に鑑み、月額固定報酬のみとしています。
5. 役員退職慰労金制度は、役員報酬体系の見直しに伴い、2006年3月期以降を廃止しました。

### ■ 内部統制システムおよびリスク管理

当社は、企業価値向上のために、また、全てのステークホルダーに対して責任のある行動をとるために、実効性のある内

部統制の強化に取り組んでいます。当社取締役会で定めた「東京エレクトロングループにおける内部統制基本方針」に基づく実践的活動を行うとともに、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制」への対応を実施しています。

### 内部統制システム

当社グループ全体の内部統制・リスク管理体制をより実効的に強化していくため、内部統制担当取締役およびコンプライアンス・内部統制担当執行役員のもと、当社総務部にリスク管理・内部統制推進の専任組織を設置し、当社グループを取り巻くリスクの評価・分析を行い、重要なリスクについては必要な施策を推進してリスク低減に努めています。また、情報セキュリティ委員会、輸出取引管理委員会を設置し、機密情報管理、輸出コンプライアンス体制の一層の強化を図っています。

### 内部監査部門における監査—監査センター

当社グループ全体の内部監査部門として、監査センターを置いています。監査センターは、当社グループの国内・海外拠点において業務監査、コンプライアンス監査、システム監査を実施し、内部統制システムが有効に機能しているか評価を行い、必要に応じて現場への業務改善の支援を行っています。

### 監査役と内部監査部門の連携

監査役は、内部監査部門である監査センターの報告会等を通じ、内部監査部門と連携をとっています。

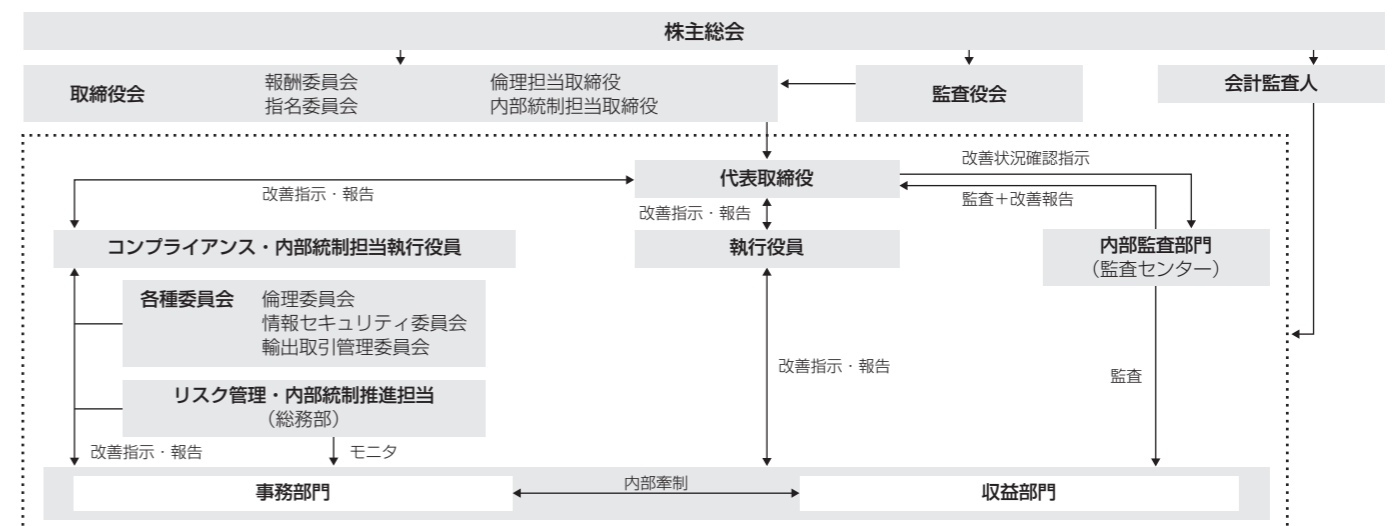
### 監査役と会計監査人との連携

監査役は、会計監査人から当期の監査計画を受領し、監査方法の概要および監査重点項目等について説明を受け、四半期・期末決算時に会計監査人からそれぞれレビューおよび監査結果に関する報告を受けています。なお、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に対し、迅速かつ正確に監査が実施できるよう、年間を通じて必要な情報、データを提供しています。

### ■ コンプライアンス

ステークホルダーからの「信頼」は事業活動の生命線です。この「信頼」を維持するためには、企業倫理とコンプライアンス（法令等遵守）を継続的に実践していくことが欠かせません。「東京エレクトロングループにおける内部統制基本方針」においても、高い倫理観やコンプライアンス意識を持つて行動することをグループ全役員・社員に求めています。

### コーポレート・ガバナンス、内部統制システムおよびリスク管理体制の模式図



## コーポレート・ガバナンス

### 倫理基準、倫理担当取締役、倫理委員会

グローバルな事業活動を行うための共通の基準として、1998年に「東京エレクトロングループ倫理基準」を制定しました。また、同1998年より、倫理担当取締役を任命するとともに、企業倫理を浸透させるための運用機関として倫理委員会を設けています。倫理基準とそのQ&Aをまとめた冊子は、日本語・英語・韓国語・中国語で作成され、海外を含むグループ全役員・社員に配布されています。さらに、環境や社会的要求の変化に応じて、倫理基準の見直しを適宜行っており、直近では2011年4月に倫理基準とそのQ&Aを改訂しています。

### コンプライアンス・内部統制担当執行役員

当社執行役員の中にコンプライアンス・内部統制担当執行役員を任命し、当社グループにおけるコンプライアンス意識の向上とさらなる徹底に努めています。

### コンプライアンスの実践・徹底に向けた取り組み

倫理基準のもと、コンプライアンスに関する基本事項を定めた「コンプライアンス規程」を制定しています。この規程は、当社グループの事業活動に従事する者が、法令・規則、国際的なルールおよび社内のルールを正確に理解し、それらに則した行動を継続的に実践することを目的としています。また、Webを活用した社員教育、社内イントラネットを通じた情報発信等、コンプライアンスの実践と意識向上の施策を実行しています。

### 内部通報制度

当社グループでは、法令や企業倫理に反する疑いのある行為について、従業員が直接情報提供を行う手段として、内部通報制度を運営しています。グループ全体の通報窓口として倫理ホットラインとコンプライアンスホットラインを設置するとともに、海外拠点においては拠点毎の通報窓口も設置しています。いずれの窓口においても、通報者の匿名性を保証するとともに、不利益がないことを確保しています。

### 株主総会に関する取り組み

当社は、株主総会の活性化および議決権行使の円滑化に向け、株主総会日の3週間以上前に株主総会招集通知を早期発送しており、株主総会を集中日以外に開催しています。また、議決権行使の方法については、インターネットを利用した議決権行使を採用するほか、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームにも参加しています。

招集通知・報告書・決議通知・議決権行使結果・株主総会のプレゼンテーション資料などもWebサイトに掲載しています。

東京エレクトロンは、  
「FTSE4Good Global Index」  
銘柄に選定されています。



当社は、ロンドン証券取引所の100%出資会社であるFTSE社が世界中の優良企業を対象にした社会的責任投資指標「FTSE4Good Global Index」の銘柄に、2003年9月以来継続して選定されています。

### コーポレート・ガバナンスに関する主な制度の有無

報酬委員会	有	代表取締役を除く取締役または監査役で構成
指名委員会	有	代表取締役を除く取締役または監査役で構成
社外取締役	有	11名中2名
社外監査役	有	5名中3名
執行役員制度	有	
代表取締役の個別報酬開示	有	1999年より開示
業績連動型報酬制度	有	
ストックオプション制度	有	社外取締役、監査役は制度の対象外
役員退職慰労金制度	無	
買収防衛策	無	



■ 取締役、監査役および執行役員

取締役、監査役および執行役員

取締役



**東 哲郎**  
代表取締役会長 兼 社長  
最高経営責任者 (CEO)



**常石 哲男**  
取締役副会長



**北山 博文**  
代表取締役副社長  
倫理担当



**佐藤 潔**  
取締役



**鷺野 憲治**  
取締役



**伊東 晃**  
取締役



**松岡 孝明**  
取締役  
技術・開発担当



**原田 芳輝**  
取締役  
内部統制担当



**堀 哲朗**  
取締役



**井上 弘\***  
取締役  
株式会社東京放送ホールディングス 代表取締役会長



**坂根 正弘\***  
取締役  
株式会社小松製作所 相談役・特別顧問

監査役



**吉田 光孝**  
常勤監査役



**森 章次郎**  
常勤監査役



**赤石 幹雄\***  
常勤監査役



**山本 高稔\***  
監査役



**酒井 竜児\***  
監査役  
長島・大野・常松法律事務所 弁護士

執行役員

**東 哲郎**  
会長・社長・CEO

**常石 哲男**  
副会長、CEO 補佐、  
Corporate Strategy 担当、IR 担当

**北山 博文**  
副社長、製造・技術担当、  
システム開発本部担当、  
IT 担当、生産本部長、  
品質担当

**鷺野 憲治**  
専務執行役員、コーポレート開発本部  
担当、ATS 担当、FPD 担当、PVE 担当

**伊東 晃**  
専務執行役員、SPE 事業担当、  
SPE 営業統括本部長 兼 ES BUGM

**伊藤 高司**  
常務執行役員、PVE 本部長

**山口 千明**  
常務執行役員、  
SPE 営業統括本部 副本部長

**鄭 基市**  
常務執行役員、SPE マーケティング・  
プロセス開発本部長

**保坂 重敏**  
常務執行役員、コーポレート開発本部長

**原田 芳輝**  
執行役員、コーポレート管理本部長、  
コンプライアンス・内部統制担当、  
人事担当、総務担当、経理担当、  
輸出・物流管理担当

**堀 哲朗**  
執行役員、コーポレート管理本部  
副本部長、経営戦略担当、財務担当、  
法務担当、知的財産担当

**長久保 達也**  
執行役員、人事担当、  
人材開発センター担当、  
コーポレートブランド推進担当、  
CSR 推進担当

**小泉 恵資**  
執行役員、IT 本部長

**池田(楊) 世崇**  
執行役員、CT BUGM

**河合 利樹**  
執行役員、SPS BUGM

**三田野 好伸**  
執行役員、ES BU 副BUGM

**多田 新吾**  
執行役員、TPS BUGM

**大久保 豪**  
執行役員、SD BUGM

**春原 清**  
執行役員、FS BUGM

**阿部 祐一**  
執行役員、ATS BUGM

**松浦 次彦**  
執行役員、FPD BUGM

**笹原 信一**  
執行役員、FPD 営業本部長

**田原 計志**  
執行役員、システム開発本部長

**川上 聡**  
執行役員、SPE マーケティング・  
プロセス開発本部 副本部長、  
TEL テクノロジーセンター仙台担当

\* 社外取締役および社外監査役

## 環境・安全・健康に対する取り組み

東京エレクトロンは、当社の継続的な成長と社会の持続的な発展のために、環境・安全・健康に対する取り組みを経営上の最重要課題の一つと位置付けています。当社が携わるあらゆる分野で環境負荷を低減すること、また、当社やお客さまの施設内における安全を確実にすることに積極的に取り組んでいます。

### ■ 環境への取り組み

#### 東京エレクトロンの新環境ビジョン

当社グループは、2008年3月期を基準として環境負荷を2015年3月末までに半減することを目標として、お客さまの工場および自社での取り組みを進めてきましたが、この目標を前倒して達成する目途が立ちました。これを機に、今後、当社グループの環境への取り組みをより多面的かつ広範囲で進めていくために、2012年9月に新しい環境ビジョンを制定しました。

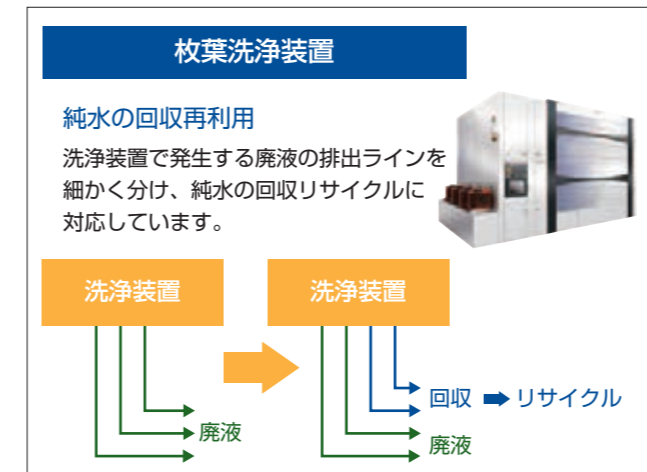
#### 新環境ビジョンに基づく新目標

新しい環境ビジョンの制定とともに、「製品貢献」「事業所」「調達・物流」「環境マネジメント」の4分野における新しい環境目標を設定しました。「製品貢献」では各ビジネスユニット

代表機種でのエネルギー50%低減・製品の環境コンプライアンス、「事業所」では省エネルギーの推進・水使用量削減・廃棄物リサイクル、「調達・物流」ではグリーン調達・モーダルシフトの推進、「環境マネジメント」では主に製造系の各事業所におけるISO 14001の取得・環境教育の実施・生物多様性に関する活動開始などを掲げ、環境活動を推進しています。



#### 製品の環境負荷低減への取り組みの一例



#### 2013年3月期の環境目標の成果

新たな環境ビジョン、環境目標を導入した初年度の成果は以下のとおりです。

#### I. 製品貢献

- 製品の環境負荷低減  
 目標である「各ビジネスユニット代表機種で2015年3月期の使用エネルギー量を2008年3月期比で50%低減」に対して、すべての代表機種でエネルギー30%低減を達成しました。
- 製品の環境コンプライアンス  
 有害物質\*削減活動と共に、継続的に適合・対応中です。  
\*日本：化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法  
 海外：RoHS、REACHなどで規制されている物質

#### II. 事業所

- 省エネルギーの推進（各地区の原単位1%削減）  
 目標を設定した国内6事業所の原油換算のエネルギー使用量において、5事業所が目標を達成しました。エネルギー使用総量は前年に比べて6%低減しました。  
 なお、2013年3月期の当社グループのGHGプロトコルで定めるScope1、2のCO<sub>2</sub>排出量は141,007トンでした。



技術交流会



クリーンルームでの安全作業に関する実技訓練

- 水使用量の削減（各地区の原単位を維持）  
 目標を設定した国内6事業所の6カテゴリー（上水、工業水など）において、5カテゴリーが目標を達成しました。水使用総量は前年に比べて6.4%低減しました。
- 廃棄物リサイクル  
 目標のリサイクル率97%以上を国内事業所で達成しました。

#### III. その他

グリーン調達ガイドライン改訂、環境Web教育実施、生物多様性に関するガイドライン策定を実施しました。

2014年3月期はこれらの活動を海外にも展開し、グローバルに継続的な改善活動を推進していきます。

### ■ 安全・健康への取り組み

当社グループでは、社員だけではなく、お客さま、取引先さまなどの安全と健康を最優先に考え、さまざまな安全活動を行っています。安全性を重視した装置設計や製造工場の環境への配慮など、企業活動のあらゆる側面で「安全・健康」を推進しています。

2013年3月期、人身事故発生件数は前年に比べて20%減少しました。また、重度の人身傷害になりうる事故の撲滅を重点目標に掲げて活動を展開した結果、これらの事故については前年度と同様に2011年3月期の発生件数から半減しました。事故の撲滅を目指し、装置搬入前のクリーンルームの事前確認、現場におけるKY（危険予知）活動、安全巡視、また事故事例を用いた教育などの再発防止活動を継続しています。

当社は、2013年に創立50周年を迎えます。これを機に安全のスローガンである「Safety First」の原点に再度立ち返り、安全文化の醸成とともに、人身事故・災害の撲滅に全社一丸となり取り組んでいきます。

より詳しい活動内容については、「東京エレクトロン環境・社会報告書2013」(2013年9月発行予定)をご覧ください。

東京エレクトロンの環境への取り組み：  
<http://www.tel.co.jp/environment/enviro/index.htm>

東京エレクトロンの安全・健康への取り組み：  
[http://www.tel.co.jp/environment/stakeholder/health\\_safety/index.htm](http://www.tel.co.jp/environment/stakeholder/health_safety/index.htm)



環境・社会報告書2012

	内容	中長期目標
製品貢献	製品の環境負荷低減	各ビジネスユニット代表機種で、2015年3月期のエネルギー使用量を2008年3月期比で50%低減
	製品の中国RoHS適合	適合を継続
	各国製品環境コンプライアンス	欧州REACH、各国GHS、電池規制への対応を継続
	製品の自主的欧州RoHS 対応推進	各ビジネスユニット代表機種で欧州RoHS適合部品率98.5%以上を継続
事業所	省エネルギーの推進	前年度比原単位 1%削減（各事業所ごとの原単位を総合評価）
	水使用量の削減	2012年3月期レベルを維持（各事業所ごとの原単位を総合評価）
	廃棄物リサイクル	● リサイクル率97%以上を維持 ● ゼロエミッション継続
調達・物流	グリーン調達	含有化学物質管理の継続実施と調達先の環境マネジメントシステムとの連携強化
	物流における環境負荷低減	● モーダルシフトを推進 ● モニタリングの継続
環境マネジメント	環境マネジメントシステム	当社グループ製造系事業所でのISO 14001取得および維持管理
	環境教育	当社全グループでの実施
	環境コミュニケーション	環境・社会報告書の継続的発行と充実
	生物多様性	調査検討の上、2014年3月期より活動開始

## 知的財産

### ■ 知的財産活動の方針

東京エレクトロンでは、知的財産（知財）活動の基本方針を、知財の保護を通して既存および新規領域での事業活動をサポートすることにより、企業収益の向上に貢献することにおいています。そのために、知財戦略は技術戦略および製品戦略に沿ったものであるべきと考え、知財ポートフォリオを充実させることにより自社製品の差別化や競争優位性を強化することに重点をおいて活動しています。充実した知財ポートフォリオは、将来的にライセンスによる収益にも貢献できると考えています。

当社が事業を行っている分野では技術がますます高度化・複雑化しており、それに伴い、新製品開発における知財紛争リスクも増大しています。激しい競争下において紛争のリスクを最小化するため、当社では知財動向を適宜調査することで他社の知的財産権を尊重し、必要に応じて他社からライセンスを取得するなど、適切な対応をとっています。

### ■ 知的財産ポートフォリオの拡充

事業成長および収益拡大を図るため、昨年度は、以下の企業の買収を通じて、新たな技術を獲得しました。

- TEL NEXX, Inc. (2012年5月買収) :  
先端パッケージング分野に関する技術
- TEL FSI, Inc. (2012年10月買収) :  
枚葉洗浄装置に関する技術
- TEL Solar AG (2012年11月買収) :  
薄膜シリコン太陽光パネル用製造装置に関する技術
- TEL Magnetic Solutions Ltd. (2012年12月買収) :  
MRAM製造に用いられる磁場中熱処理に関する技術

注：買収後の社名を表記しています。

当社知財部門は、これら企業の買収において、各社所有の知財が当社ポートフォリオに統合され、各社の知財活動が当社知財方針に沿って行われるよう活動しています。

### ■ 知的財産活動の体制

お客さまの要求により高いレベルで応え、新たな市場を切り拓いていくため、当社は常に積極的な研究開発を行っています。研究開発の成果による競争優位を維持するためには、知的財産

権を着実に取得することにより、その成果を保護することが不可欠です。そのため、研究開発部門と密に連携しながら知的財産権の取得を行えるよう、製品開発・製造拠点のなかあるいは近くに、知財担当者を配しています。加えて、海外における研究開発の活発化に伴い、米国を始めとする海外拠点にも担当者を配置しています。

知財活動を実効的なものとするためには、激しく変化する市場・技術動向への柔軟な対応も求められます。市場・技術動向をタイムリーに把握できるよう、知財に関する調査・渉外業務の担当者を、営業・マーケティング部門がある本社に配置しています。加えて、常に知財活動が市場・技術動向に対応したものとなるよう、事業や開発領域ごとに知財委員会を定期的に開催しています。当該委員会は、知財担当者、事業部門責任者および開発部門責任者から構成されており、知財の評価、知財戦略の検討、費用対効果の観点に基づく権利化方法の決定などを行っています。前述の通り、当社は昨年度に複数の会社を買収しました。知財担当者は、知財委員会の立ち上げなど、知財の観点からこれら買収企業の統合に積極的に関わっています。

### ■ 知的財産権の状況

当社事業分野への参入障壁を強固なものとするため、コア技術を中心とした知財ポートフォリオの構築を積極的に推進し、将来の技術的成長を確保しています。

各地域における当社の特許出願<sup>\*1</sup>ならびに保有<sup>\*2</sup>状況は下記のグラフの通りです。昨年度の企業買収に伴って獲得した特許も、当社の知財ポートフォリオの充実に貢献しています。

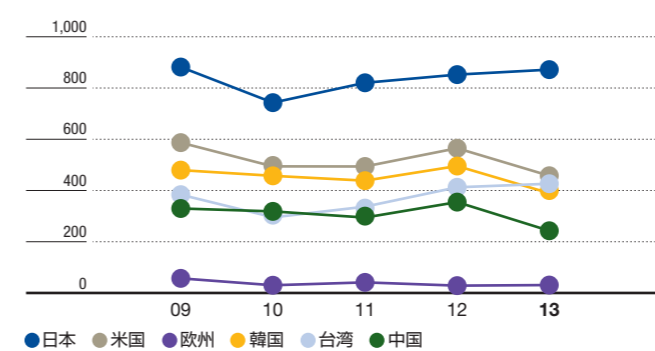
前述の知財委員会は、絶えず変化する市場・技術・競合の動向ならびに費用対効果を含むさまざまな観点に照らし、定期的に特許の出願・維持方針を見直しています。近年、当社のグローバル出願率<sup>\*3</sup>は70%を維持していますが、地域ごとの出願件数については常に最適化を図っています。

<sup>\*1</sup>買収会社の出願については、買収後のもののみカウントしています。

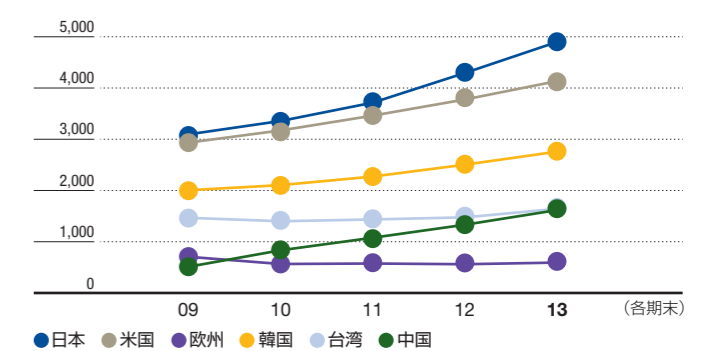
<sup>\*2</sup>買収に伴って取得された全ての特許を含みます。それら取得特許の地域ごとの件数は次のとおりです：日本(38)、米国(132)、欧州(102)、韓国(30)、台湾(18)、中国(38)。

<sup>\*3</sup>日本国特許庁への特許出願のうち外国に出願される件数の比率。日本企業の平均は約25%。

### 特許出願件数



### 特許保有件数



## ■ 財務概況

## 財務概況

## 損益状況

## 当期の事業環境

2013年3月期は、欧州債務問題の長期化、米国の財政問題等による先行き不安および中国をはじめとする新興国の成長率鈍化により世界的に景気不安感が広がりましたが、年度末には景気は緩やかな回復の動きをみせました。また、日本経済においても、年度末にかけて円高是正が急速に進みましたが、長期にわたる円高の影響や世界経済の減速懸念を背景に、年間を通してみれば景気は総じて低調に推移し、回復は緩やかなものに留まりました。

当社の参画するエレクトロニクス産業においては、スマートフォンの普及が本格化し市場の牽引役となったものの、パソコンやテレビ等の販売不振により半導体メモリおよび液晶パネルの需給バランスが悪化し、当社の顧客である半導体メーカーおよびFPD(フラットパネルディスプレイ)メーカーの設備投資が抑制されました。

## 当期の企業買収

2013年3月期、NEXX Systems, Inc.(現TEL NEXX, Inc.)、FSI International, Inc.(現TEL FSI, Inc.)、Oerlikon Solar Holding AG(現TEL Solar Holding AG)、Magnetic Solutions Ltd.(現TEL Magnetic Solutions Ltd.)の計4社の買収を行いました。

TEL Solar Holding AGについては、貸借対照表のみが当期から連結され、貸借対照表以外の計算書の連結は2014年3月期からになります。

なお、TEL Solar Holding AGを除く3社については、いずれの買収も当期業績に与える影響は軽微でした。

買収に関する補足情報については、連結財務諸表注記20.企業結合(P31～33)をご参照ください。

## 売上の状況

事業環境低迷の影響を受け、主力である半導体製造装置およびFPD製造装置の売上が大きく減少したために、当期の売上高は前期比21.4%減少の4,973億円となりました。

国内売上高は前期比30.8%減少の1,185億円、海外売上高は18.0%減少の3,788億円となり、連結売上高に占める海外売上高の比率は前期の72.9%から76.2%へと3.3ポイント上昇しました。

なお、当期の受注高は前期比16.7%減少の4,506億円、当期末の受注残高は16.5%減少の1,808億円となりました。

## 売上総利益、販売費及び一般管理費、営業利益(損失)

売上原価は前期比19.7%減少の3,385億円となりましたが、売上高の減少率が上回ったため、売上原価率は前期から1.5ポイント悪化の68.1%となりました。

これにより、売上総利益は24.9%減少の1,588億円となり、売上総利益率は前期の33.4%から31.9%に低下しました。

販売費及び一般管理費は、前期比3.2%減少の1,462億円となりましたが、連結売上高に対する比率は前期の23.9%から29.4%に上昇しました。

なお、当期、全社ベースで約160億円に上る固定費削減策を実行し、収益性の改善に努めました。

これらの結果、営業利益は前期比79.2%減少の125億円、営業利益率は前期の9.5%から2.5%に低下しました。

## 研究開発費

研究開発費は、前期比10.1%減少の732億円となりました。前期に比べて減少しましたが、技術開発が当社の成長の源泉であるとの考えは変わらず、既存分野の強化のみならず、今後の成長が見込まれる新規分野に当期も積極的な投資を行いました。対売上高比率は前期の12.9%から14.7%に上昇しました。

半導体製造装置分野では、多様化する技術に対応すべく、各製品カテゴリにおいて新製品開発の強化に努めました。3次元構造デバイス等の次世代デバイスに要求されるプロセス技術・装置開発をはじめ、先端パッケージング技術、さらには省エネルギー化の要求に対応するための省電力化技術等、環境に配慮した技術開発にも注力しました。また、次世代メモリの製造技術、将来のウェーハの大口径化(450mmウェーハ)のための装置開発等にも着手しています。

FPD/PV製造装置分野では、有機ELディスプレイ製造装置の開発、薄膜シリコン太陽光パネル製造装置のさらなる変換効率向上を目指した装置開発を行いました。

また、基礎・要素研究関連では、さらなる微細化のための新プロセス技術や新材料に対応するプロセス技術など、他社との差別化を図るための各種コア技術の開発に注力しました。

## その他収益(費用)および当期純利益

当期は、主な収益として受取利息及び受取配当金17億円、補助金収入27億円を、また主な費用として純額で為替差損15億円を計上しました。その結果、その他収益(費用)は純額で52億円の収益となりました。

この結果、税金等調整前当期純利益は70.7%減少の178億円、当期純利益は83.5%減少の61億円を計上することとなりました。1株当たり当期純利益は前期の205.04円から33.91円となりました。

## 包括利益

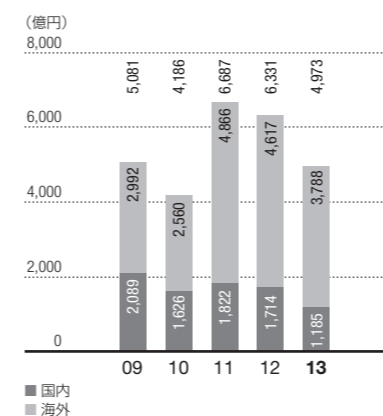
当期は、期末にかけて急速に進んだ円安の影響により為替換算調整勘定として88億円の利益を計上しましたが、当期純利益が前期から大きく減少したため、包括利益は前期比57.2%減少の158億円となりました。

## 配当政策および当期配当金

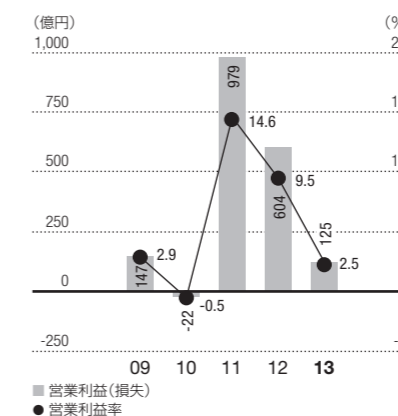
当社は、業績連動型・収益対応型の配当を株主還元の基本方針とし、連結当期純利益に対する配当性向35%を目途とする配当を実施しています。当期は、当社の創立50年目にあたることから記念配当20円を加え、通期の1株当たり配当金は51円(配当性向150.4%)となりました。

損益状況	百万円				
	2009	2010	2011	2012	2013
売上高	¥508,082	¥418,637	¥668,722	¥633,091	¥497,300
売上総利益	137,408	108,316	234,758	211,445	158,755
売上総利益率	27.0%	25.9%	35.1%	33.4%	31.9%
販売費及び一般管理費	122,697	110,497	136,888	151,002	146,206
営業利益(損失)	14,711	(2,181)	97,870	60,443	12,549
営業利益率	2.9%	(0.5)%	14.6%	9.5%	2.5%
税金等調整前当期純利益(損失)	9,637	(7,768)	99,579	60,602	17,767
当期純利益(損失)	7,543	(9,033)	71,924	36,726	6,076

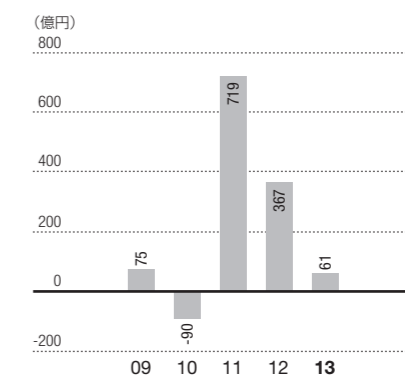
## 国内および海外売上高



## 営業利益(損失)および営業利益率



## 当期純利益(損失)



■ 財務概況

財務概況

セグメント別の状況

■ 半導体製造装置

スマートフォン、タブレット等の先端モバイル機器に牽引され、ロジック向け半導体設備投資は比較的堅調でしたが、パソコン出荷の低迷等を背景に、メモリ向け半導体設備投資が低調であった前期からさらに縮小しました。

当セグメントの外部顧客に対する売上高は18.0%減少の3,920億円となりました。セグメント間の内部売上高又は振替高を含む当セグメントの売上高は、前期比18.0%減少の3,921億円、セグメント利益は前期比45.4%減少の486億円、セグメント利益率は前期の18.6%から12.4%に低下しました。

当期の受注高は前期比21.7%減少の3,425億円、期末の受注残高は前期比24.9%減少の1,416億円となりました。

当部門の営業概況については、P13をご参照ください。

■ FPD/PV(フラットパネルディスプレイおよび太陽光パネル)製造装置

モバイル機器向けの中小型パネル用設備投資は堅調でしたが、薄型テレビ需要が先進国で一巡したことを背景に大型パネル用設備投資が先送りされ、FPD製造装置市場が大幅に縮小しました。

当セグメントの外部顧客に対する売上高は前期比71.2%減少の202億円となりました。また、セグメント間の内部売上高又は振替高を含む当セグメントの売上高も前期比71.2%減少の202億円、セグメント利益は前期の23億円の利益計上から64億円の損失計上となりました。なお、FPD製造装置売上が当セグメント売上のほぼ100%を占めました。

当期の受注高は前期比18.1%増加の220億円、期末の受注残高は前期比72.0%増加の244億円となりました。

当部門の営業概況については、P13をご参照ください。

■ 電子部品・情報通信機器

国内電子部品市場は、民生用電子機器・産業機器向けともに低水準でしたが、データセンターなどのクラウドコンピューティング市場は拡大基調にありました。

当セグメントの外部顧客に対する売上高は前期比0.2%減少の847億円となりました。セグメント間の内部売上高又は振替高を含むセグメント売上高は、前期比1.0%減少の855億円、セグメント利益は前期比44.5%減少の13億円、セグメント利益率は前期の2.7%から1.5%に低下しました。

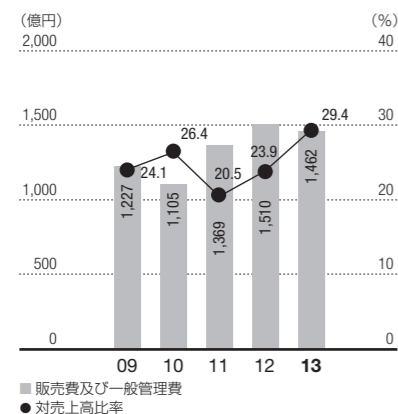
当部門の営業概況については、P13をご参照ください。

■ その他

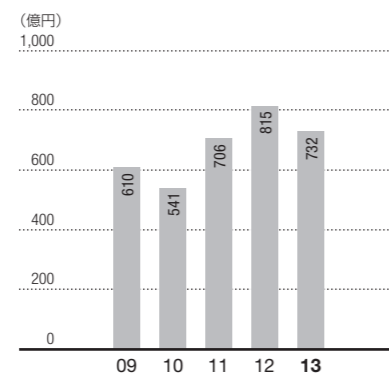
その他の売上は、当社グループの物流、施設管理および保険業務等の内部サービス関連業務の売上です。なお、当部門の外部顧客に対する売上高は4億円となり、前期とほとんど変化はありませんでした。

セグメント情報	報告セグメント				合計	調整額	連結財務諸表計上額
	半導体製造装置	FPD/PV製造装置	電子部品・情報通信機器	その他			
2013:							
売上高							
外部顧客への売上高	¥392,027	¥20,160	¥84,665	¥ 448	¥497,300	¥ —	¥497,300
セグメント間の内部売上高又は振替高	43	—	813	10,613	11,469	(11,469)	—
計	392,070	20,160	85,478	11,061	508,769	(11,469)	497,300
セグメント利益(損失)	48,600	(6,355)	1,283	1,321	44,849	(27,082)	17,767
セグメント資産	223,956	49,489	47,557	1,550	322,552	452,976	775,528
減価償却費	12,330	462	448	78	13,318	13,313	26,631
のれんの償却額	1,038	—	103	—	1,141	—	1,141
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	13,464	1,661	482	54	15,661	9,834	25,495

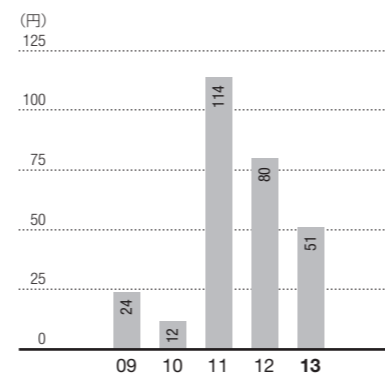
販売費及び一般管理費および対売上高比率



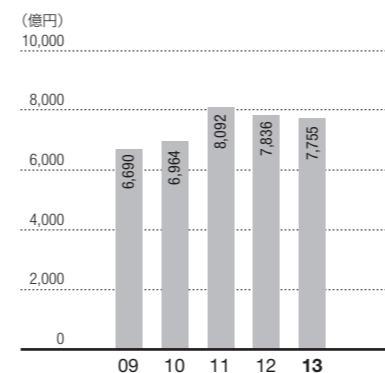
研究開発費



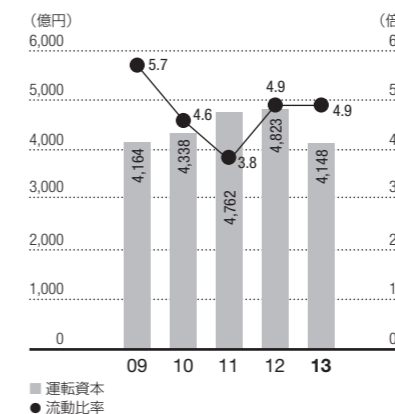
1株当たり配当金



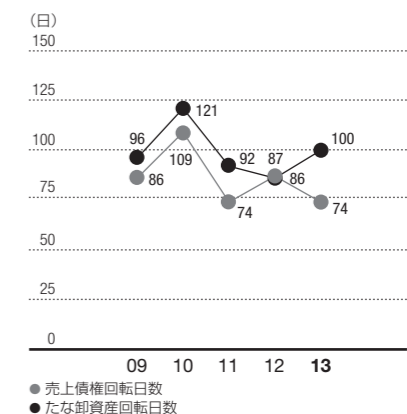
総資産



運転資本および流動比率



売上債権回転日数およびたな卸資産回転日数



■ 財務概況

財務概況

財政状態およびキャッシュ・フロー

資産、負債及び純資産

■ 資産

流動資産は、前期末に比べ855億円減少し、5,215億円となりました。主な内容は、受取手形及び売掛金の減少498億円、たな卸資産の減少138億円、手元流動性(現金及び現金同等物に短期投資を加えたもの)の減少75億円によるものです。なお、売上債権回転日数は前期の87日から74日に改善、たな卸資産回転日数は前期の86日から100日に悪化しました。

有形固定資産は、新規取得分が218億円ありましたが、減価償却実施額266億円等を差し引き、純額で88億円増加の1,357億円となりました。

投資その他の資産は、前期末から687億円増加し、1,183億円となりました。海外4社の企業買収によるのれんの増加384億円および無形固定資産の増加168億円が主な増加の要因です。これらの結果、総資産は、前期末から81億円減少し、7,755億円となりました。

■ 負債及び純資産

流動負債は、前期末に比べ181億円減少し1,067億円となりました。主な減少要因は、支払手形及び買掛金の減少107億円、前受金の減少74億円です。有利子負債は前期の44億円から38億円に減少し、デット・エクイティ・レシオ(有利子負債/自己資本)は前期末比0.2ポイント低下の0.6%となりました。

長期負債は、退職給付引当金の20億円の増加を主要因に前期末比35億円増加し637億円となりましたが、流動負債と長期負債を合わせた負債合計は、前期末に比べ146億円減少して1,704億円となりました。

純資産は、前期末に比べ65億円増加し6,051億円となりました。主として、当期純利益61億円の計上および配当金93億円の支払いによる利益剰余金33億円の減少、円安による為替換算調整勘定の87億円の増加によるものです。この結果、自己資本比率は前期の74.9%から1.6ポイント上昇し、76.5%となりました。一方、自己資本当期純利益率(ROE)は前期の6.3%から1.0%に低下しました。

設備投資額\*1および減価償却費\*2

当期の設備投資額は、複数の開発製造拠点が設立された前期と比較して44.9%減少の218億円となりました。

当期は、半導体製造装置事業およびFPD/PV製造装置事業において、高成長が期待できる分野を中心に評価用機械装置等の取得を行いました。また、当期より新研究開発拠点として稼働を開始したつくば市のテクノロジーセンターおよび韓国ファソン市のプロセス開発センターにて使用する開発・評価用機械装置の購入にも資金を投じました。

減価償却費は10.1%増加の266億円でした。

\*1 設備投資額は有形固定資産の増加分を示しています。  
\*2 減価償却費にはのれん償却額および減損損失は含まれていません。

キャッシュ・フロー

営業活動により獲得したキャッシュ・フローは、前期比546億円増加の843億円となりました。主な内容として、税金等調整前当期純利益178億円、売上債権の減少575億円、減価償却費266億円、たな卸資産の減少203億円がそれぞれキャッシュ・フローの増加要因に、仕入債務の減少155億円、前受金の減少125億円が減少要因となりました。

投資活動により支出したキャッシュ・フローは、前期の84億円から1,418億円となりました。定期預金および短期投資の純増による支出661億円、有形固定資産の取得による支出190億円に加え、企業買収(現金を対価とする株式の取得)4件に551億円支出したために、大幅な増加となりました。

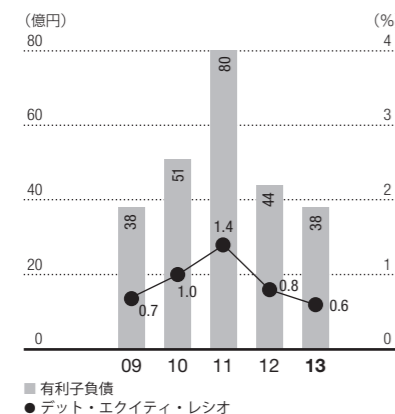
財務活動により支出したキャッシュ・フローは、主に配当金の支払い93億円により、前期の273億円に対し106億円となりました。

現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ735億円減少し、853億円となりました。なお、現金及び現金同等物に短期投資を加えた残高(手元流動性)は、前期末に比べ75億円減少し、2,401億円となりました。

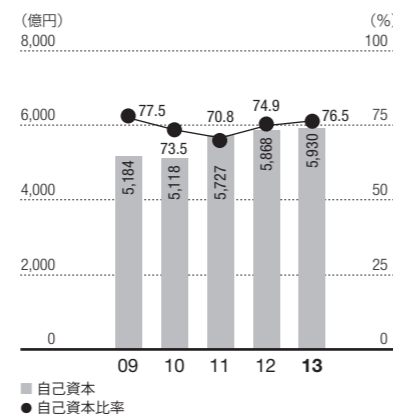
財政状態	百万円				
	2009	2010	2011	2012	2013
流動資産	¥505,687	¥552,939	¥644,231	¥607,051	<b>¥521,501</b>
有形固定資産	99,906	92,128	112,552	126,885	<b>135,698</b>
投資その他資産	63,405	51,285	52,422	49,675	<b>118,329</b>
総資産	668,998	696,352	809,205	783,611	<b>775,528</b>
流動負債	89,272	119,162	168,038	124,794	<b>106,670</b>
負債合計	139,733	172,982	224,403	185,008	<b>170,401</b>
純資産	529,265	523,370	584,802	598,603	<b>605,127</b>

キャッシュ・フロー	百万円				
	2009	2010	2011	2012	2013
営業活動によるキャッシュ・フロー	¥ 81,030	¥ 48,285	¥ 83,239	¥ 29,712	<b>¥ 84,267</b>
投資活動によるキャッシュ・フロー	(160,622)	9,613	(35,882)	(8,352)	<b>(141,769)</b>
財務活動によるキャッシュ・フロー	(46,016)	(288)	(5,237)	(27,335)	<b>(10,625)</b>
現金及び現金同等物期末残高	65,883	123,940	165,051	158,776	<b>85,314</b>

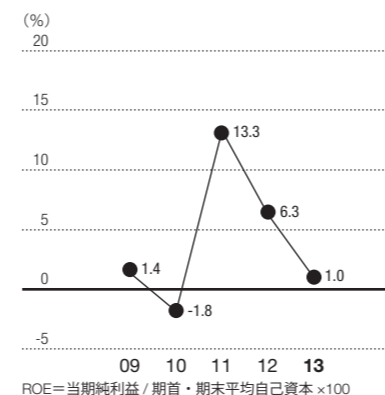
有利子負債および  
デット・エクイティ・レシオ



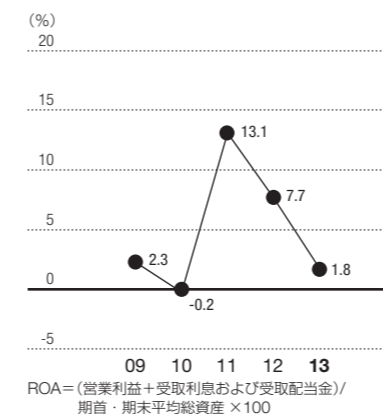
自己資本および自己資本比率



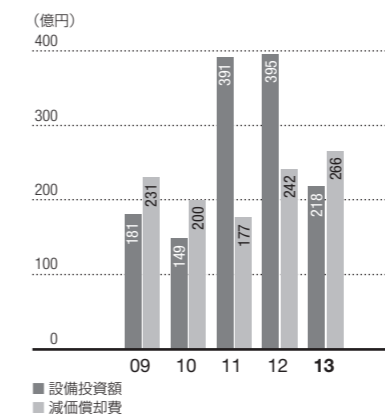
ROE



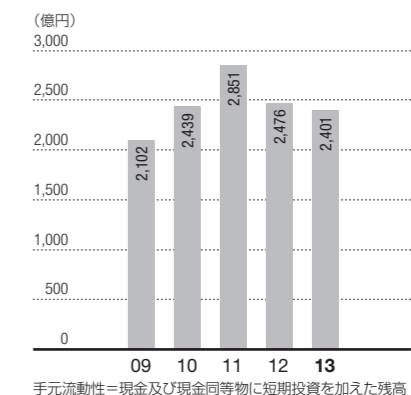
ROA



設備投資額および減価償却費



手元流動性



## ■ 財務概況

## 財務概況

## 事業等のリスク

当社の経営成績、財務状況及び当社株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

## (1)半導体市場変動による影響

当社は、技術革新が激しく自らの強みを発揮できる半導体製造装置等のハイテク分野に資源を集中させることにより、高い利益率を獲得してきました。半導体市場は技術の変化により大幅に成長する反面、需給バランスが崩れることによって市場規模が一時的に縮小することがあるため、当社はこのような局面においても利益を生み出せるように構造改革にも積極的に取り組んできました。しかしながら、予期せぬ市場規模の大幅な縮小によって、受注取消、過剰設備・人員、在庫増加、顧客の財務状況悪化による貸倒損失、仕入先の経営状態悪化による供給不足等が発生する場合には、当社業績に少なからず悪影響を及ぼす可能性があります。

## (2)特定顧客への取引集中による影響

当社は、優れた最先端技術を搭載した製品及び顧客満足度の高いサービス体制を通じて、国内の大手半導体メーカーを含む、世界中の主要な大手半導体メーカーとの取引拡大に成功してきました。大手半導体メーカーの大規模設備投資のタイミングによっては売上高が特定の顧客に一時的に集中することがあり、販売競争の激化によって当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

## (3)研究開発による影響

当社は、微細加工技術、真空技術、プラズマ技術、熱処理技術、塗布・現像技術、洗浄技術、ウェーハ搬送技術、クリーン化技術等の最先端技術について積極的な研究開発投資及び研究開発活動を継続的に実施することにより、最先端の技術を創造するとともに、当該技術を搭載した新製品を早期市場投入することによって当社が参入する各製品分野において上位の市場シェアと高い利益率の獲得に成功してきました。しかしながら、新製品投入タイミングのずれ等の影響により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

## (4)安全に関する影響

当社は、開発・製造・販売・サービス・管理等の各種業務の遂行において安全や健康に対する配慮を常に念頭において行動するという基本理念のもと、当社製品の安全性向上や健康影響排除のために積極的かつ継続的に努力しております。しかしながら、当社製品に関連する安全性等の問題により、顧客への損害発生、受注取消等が発生した場合、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

## (5)品質に関する影響

当社は、優れた最先端技術を積極的に開発し新製品に搭載し早期に市場に投入すると同時に、ISO9001の認証取得を含む品質保証体制の確立、及びレベルの高いサービス体制の確立にも努め、その結果、当社の製品を多くの顧客に採用していただくことができました。しかしながら、当社の製品が最先端技術製品である等の原因によって、未知の分野の開発技術も多く存在し、予期せぬ不具合品が発生する等により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

## (6)知的財産権に関する影響

当社は、製品の差別化と競争力強化のために、最先端技術早期開発のための研究開発戦略を事業戦略及び知的財産戦略と三位一体で推進することにより、多くの独自技術の専有化を可能とし、各製品分野における高い市場シェアと利益率の確保に成功してきました。しかしながら、当社の製品は多くの最先端技術が統合・最適化された製品であることもあり、第三者の技術や特許その他の知的財産権を使用する上で制約される場合等があるため、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

## (7)外国為替変動による影響

当社は、事業の積極的な海外展開に成功したことにより、海外への売上高比率が高くなっております。当社の輸出は為替リスクを回避するために円建て取引にて行うことを原則としておりますが、一部外貨建て輸出も存在し、その場合には受注時の先物為替予約等によって為替リスクヘッジに努めております。しかしながら、急激な為替変動によって価格の変動が生じ為替リスクとなることがあり、当社業績に間接的に悪影響を及ぼす可能性があります。

## (8)企業買収による影響

当社は、事業戦略の一環として、新たな事業領域への進出、新技術・ビジネス基盤の獲得、既存事業の競争力強化などを目的とした企業買収を実施することがあります。具体的な実施にあたっては入念な調査・検討を行っております。しかしながら、買収後に当初期待した成果が十分に得られなかった場合には、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

## (9)その他リスク

当社は、新たな高成長・高収益事業の創出、既存事業における更なる高収益の追求、市場規模縮小時においても利益を生み出すことのできる体質への改善に積極的に取り組むとともに、環境保全活動の推進、コンプライアンスやリスク管理体制及び情報セキュリティ管理体制の再整備にも取り組んできました。しかしながら、当社が事業を遂行する限りにおいては、同業他社及び他業種企業と同様に、世界及び各地域における経済環境、自然災害、戦争、テロ、感染症等の不可抗力、金融・株式市場、政府等による規制、仕入先の供給体制、商品・不動産市況、国内外での人材確保、標準規格化競争、重要人材の喪失等の影響を受け、場合によっては当社業績に悪影響を及ぼすことが想定されます。

## ■ 11年間の主要財務データ

## 11年間の主要財務データ

東京エレクトロン株式会社及び連結子会社  
2003年3月期から2013年3月期

この日本語版アニュアルレポートは、海外の読者向けに作成された英語版アニュアルレポートを翻訳したものです。従って、その連結財務諸表部分は、日本で公表されている連結財務諸表を基礎として作成されておりますが、表示上異なる箇所があります。

	千米ドル						百万円					
	2013	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
売上高 <sup>1</sup>	\$5,287,613	¥ 497,300	¥ 633,091	¥ 668,722	¥ 418,637	¥ 508,082	¥ 906,092	¥ 851,975	¥ 673,686	¥ 635,710	¥ 529,654	¥ 460,580
半導体製造装置	4,168,283	392,027	477,873	511,332	262,392	325,383	726,440	642,625	486,883	457,191	425,747	364,689
FPD/PV製造装置 <sup>2</sup>	214,354	20,160	69,889	66,721	71,361	88,107	68,016	100,766	81,176	75,038	—	—
コンピュータ・ネットワーク	—	—	—	—	—	—	—	19,169	17,497	15,966	18,448	17,193
電子部品・情報通信機器	900,213	84,665	84,868	90,216	84,473	94,207	111,181	88,294	86,881	86,249	84,229	77,380
その他	4,763	448	461	453	411	385	455	1,121	1,249	1,266	1,230	1,318
営業利益(損失)	133,429	12,549	60,443	97,870	(2,181)	14,711	168,498	143,979	75,703	63,983	22,280	1,119
税金等調整前当期純利益(損失)	188,910	17,767	60,602	99,579	(7,768)	9,637	169,220	144,414	75,328	55,775	14,936	(23,010)
当期純利益(損失)	64,604	6,076	36,726	71,924	(9,033)	7,543	106,271	91,263	48,006	61,601	8,297	(41,554)
包括利益 <sup>3</sup>	168,272	15,826	36,954	69,598	(4,751)	—	—	—	—	—	—	—
国内売上高	1,260,011	118,504	171,364	182,165	162,609	208,871	323,946	313,816	262,532	232,678	242,318	190,513
海外売上高	4,027,602	378,796	461,727	486,557	256,028	299,211	582,146	538,159	411,154	403,032	287,336	270,067
減価償却費 <sup>4</sup>	283,158	26,631	24,198	17,707	20,002	23,068	21,413	18,820	19,170	21,463	24,963	27,374
設備投資額 <sup>5</sup>	231,515	21,774	39,541	39,140	14,919	18,108	22,703	27,129	13,335	9,876	11,007	12,359
研究開発費	778,830	73,249	81,506	70,568	54,074	60,988	66,073	56,962	49,182	43,889	44,150	50,123
総資産	8,245,912	775,528	783,611	809,205	696,352	668,998	792,818	770,514	663,243	644,320	561,632	524,901
純資産 <sup>6</sup>	6,434,099	605,127	598,603	584,802	523,370	529,265	545,245	469,811	376,900	332,165	275,800	252,904
従業員数(人)		12,201	10,684	10,343	10,068	10,391	10,429	9,528	8,901	8,864	8,870	10,053
1株当たり当期純利益(損失) <sup>7</sup>												
1株当たり当期純利益(損失)	\$ 0.36	¥ 33.91	¥ 205.04	¥ 401.73	¥ (50.47)	¥ 42.15	¥ 594.01	¥ 511.27	¥ 267.61	¥ 343.63	¥ 46.37	¥ (238.57)
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 <sup>8</sup>	0.36	33.85	204.72	401.10	—	42.07	592.71	509.84	267.32	343.54	45.78	—
1株当たり純資産額	35.19	3,309.58	3,275.14	3,198.66	2,859.37	2,896.55	2,989.70	2,573.72	2,112.30	1,863.28	1,543.73	1,456.23
1株当たり配当額	0.54	51.00	80.00	114.00	12.00	24.00	125.00	103.00	55.00	45.00	10.00	8.00
発行済株式総数(単位:千株)		180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	175,698
株主総数(人)		41,287	42,414	44,896	39,285	42,509	43,324	41,289	46,272	60,857	60,873	49,259
自己資本当期純利益率(ROE)		1.0	6.3	13.3	(1.8)	1.4	21.4	21.8	13.5	20.3	3.1	(14.8)
営業利益率		2.5	9.5	14.6	(0.5)	2.9	18.6	16.9	11.2	10.1	4.2	0.2
自己資本比率		76.5	74.9	70.8	73.5	77.5	67.5	59.7	56.8	51.6	49.1	48.2
総資産回転率(回)		0.64	0.79	0.89	0.61	0.70	1.16	1.19	1.03	1.05	0.97	0.85
従業員1人当たり売上高	\$ 433,376	¥ 40,759	¥ 59,256	¥ 64,655	¥ 41,581	¥ 48,896	¥ 86,882	¥ 89,418	¥ 75,687	¥ 71,718	¥ 59,713	¥ 45,815

1 2004年3月期までは、FPD(Flat Panel Display)製造装置は半導体製造装置に含めております。2008年3月期より、コンピュータ・ネットワークは、電子部品・情報通信機器に含めております。

2 2009年3月期より、FPD製造装置はFPD/PV製造装置に名称変更致しました。太陽光パネル(PV)製造装置は、FPD/PV製造装置に含まれております。

3 2011年3月期より、ASBJ(企業会計基準委員会)発表の「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号)を適用しております。それに伴い、2010年3月期より包括利益を開示しております。

4 のれん償却額および減損損失は含まれておりません。

5 設備投資額は、有形固定資産の増加分を示しております。

6 2007年3月期より、純資産は「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号)に基づいて開示をしております。2006年3月期以前は株主資本として以前の会計基準に基づき表示しております。

7 2003年3月期より、ASBJ発表の「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。

8 2011年3月期より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 2010年6月30日)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 2010年6月30日公表分)を適用しております。

なお、2003年3月期及び2010年3月期は、希薄化の影響はありません。

9 2005年3月期より、半導体製造装置及びFPD製造装置に係る収益の計上基準を、出荷基準から原則として設置完了基準に変更しております。この変更に伴い、2005年3月期は従来の方法によった場合に比べ、売上高は80,956百万円、営業利益、税金等調整前当期純利益はそれぞれ20,541百万円、20,563百万円減少しております。

10 半導体製造装置及びFPD製造装置に係る保証期間中のアフターサービス費用については、従来、支出時の費用として計上してはいたしましたが、2005年3月期より、過去の支出実績を基準にして算出した見積額を製品保証引当金として計上することに変更しております。この変更に伴い、2005年3月期は従来の方法によった場合に比べ、営業利益、税金等調整前当期純利益はそれぞれ635百万円、13,106百万円減少しております。



## ■ 連結貸借対照表

## 連結貸借対照表

東京エレクトロン株式会社及び連結子会社  
2013年3月31日及び2012年3月31日現在

資産	百万円		千米ドル
	2013	2012	2013
<b>流動資産：</b>			
現金及び現金同等物	¥ 85,314	¥158,776	\$ 907,113
短期投資	154,816	88,849	1,646,103
受取手形及び売掛金	100,501	150,306	1,068,591
貸倒引当金	(1,180)	(1,376)	(12,546)
たな卸資産	135,698	149,470	1,442,828
繰延税金資産	15,669	23,546	166,603
前払費用及びその他流動資産	30,683	37,480	326,242
流動資産合計	521,501	607,051	5,544,934
<b>有形固定資産：</b>			
土地	25,030	26,260	266,135
建物及び構築物	163,857	143,462	1,742,233
機械装置・運搬具及び工具器具備品	140,066	115,834	1,489,271
建設仮勘定	6,076	9,515	64,604
合計	335,029	295,071	3,562,243
減価償却累計額	199,331	168,186	2,119,415
有形固定資産合計	135,698	126,885	1,442,828
<b>投資その他資産：</b>			
投資有価証券	18,669	16,082	198,501
繰延税金資産	23,206	17,585	246,741
のれん	38,373	—	408,006
無形固定資産	21,545	4,704	229,080
その他資産	18,648	15,152	198,278
貸倒引当金	(2,112)	(3,848)	(22,456)
投資その他資産合計	118,329	49,675	1,258,150
<b>資産合計</b>	<b>¥775,528</b>	<b>¥783,611</b>	<b>\$8,245,912</b>

連結財務諸表注記参照

負債及び純資産	百万円		千米ドル
	2013	2012	2013
<b>流動負債：</b>			
支払手形及び買掛金	¥ 36,261	¥ 46,987	\$ 385,550
前受金	18,985	26,373	201,861
製品保証引当金	8,345	8,904	88,729
未払費用及びその他流動負債	43,079	42,530	458,044
流動負債合計	106,670	124,794	1,134,184
<b>退職給付引当金</b>	<b>57,225</b>	<b>55,266</b>	<b>608,453</b>
<b>その他固定負債</b>	<b>6,506</b>	<b>4,948</b>	<b>69,176</b>
負債合計	170,401	185,008	1,811,813
<b>純資産：</b>			
<b>株主資本</b>			
資本金、普通株式 授権株式数：300,000,000株 発行済株式総数：2013年及び2012年3月31日現在 180,610,911株	54,961	54,961	584,381
資本剰余金	78,023	78,023	829,591
利益剰余金	467,921	471,186	4,975,237
自己株式 2013年3月31日現在 1,424,203株 2012年3月31日現在 1,446,079株	(9,589)	(9,748)	(101,956)
<b>その他の包括利益累計額</b>			
その他有価証券評価差額金	4,214	3,576	44,805
繰延ヘッジ損益	(15)	(51)	(159)
為替換算調整勘定	(2,484)	(11,158)	(26,412)
<b>新株予約権</b>	<b>1,375</b>	<b>1,157</b>	<b>14,620</b>
<b>少数株主持分</b>	<b>10,721</b>	<b>10,657</b>	<b>113,992</b>
純資産合計	605,127	598,603	6,434,099
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>¥775,528</b>	<b>¥783,611</b>	<b>\$8,245,912</b>

■ 連結損益計算書 ■ 連結包括利益計算書

## 連結損益計算書

東京エレクトロン株式会社及び連結子会社  
2013年3月期及び2012年3月期

	百万円		千米ドル
	2013	2012	2013
売上高	¥497,300	¥633,091	\$5,287,613
売上原価	338,545	421,646	3,599,628
売上総利益	158,755	211,445	1,687,985
販売費及び一般管理費	146,206	151,002	1,554,556
営業利益	12,549	60,443	133,429
その他収益(費用)：			
受取利息及び受取配当金	1,659	1,010	17,640
補助金収入	2,672	1,740	28,410
貸倒引当金繰入額	—	(1,848)	—
貸倒引当金戻入額	558	—	5,933
固定資産売却益	943	566	10,027
固定資産除売却損	(153)	(406)	(1,627)
償却債権取立益	—	1,437	—
為替差損	(1,520)	(32)	(16,162)
関係会社整理損	(134)	—	(1,425)
組織再編費用	(132)	—	(1,403)
事業再編損失	—	(849)	—
投資有価証券評価損	(44)	(817)	(468)
災害による損失	—	(936)	—
その他—純額	1,369	294	14,556
税金等調整前当期純利益	17,767	60,602	188,910
法人税等：			
法人税、住民税及び事業税	6,255	15,023	66,507
過年度法人税等	2,195	—	23,339
法人税等調整額	2,959	8,400	31,462
少数株主損益調整前当期純利益	6,358	37,179	67,602
少数株主利益	282	453	2,998
当期純利益	¥ 6,076	¥ 36,726	\$ 64,604

1株当たり情報：	円		米ドル
	円	円	米ドル
当期純利益	¥ 33.91	¥ 205.04	\$ 0.36
潜在株式調整後当期純利益	33.85	204.72	0.36
純資産額	3,309.58	3,275.14	35.19
配当金	51.00	80.00	0.54

連結財務諸表注記参照

## 連結包括利益計算書

東京エレクトロン株式会社及び連結子会社  
2013年3月期及び2012年3月期

	百万円		千米ドル
	2013	2012	2013
少数株主損益調整前当期純利益	¥ 6,358	¥37,179	\$ 67,602
その他の包括利益：			
その他有価証券評価差額金	652	769	6,933
繰延ヘッジ損益	56	(69)	595
為替換算調整勘定	8,760	(925)	93,142
その他の包括利益合計	9,468	(225)	100,670
包括利益	15,826	36,954	168,272
(内訳)			
親会社株主に係る包括利益	15,426	36,532	164,019
少数株主に係る包括利益	400	422	4,253

連結財務諸表注記参照

## 連結株主資本等変動計算書

東京エレクトロン株式会社及び連結子会社  
2013年3月期及び2012年3月期

	百万円										
	株主資本				その他の包括利益累計額						純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	その他 有価証券 評価差額金	繰延 ヘッジ 損益	為替勘算 調整勘定	新株 予約権	少数株主 持分		
2011年4月1日残高	¥54,961	¥78,046	¥457,658	¥(10,484)	¥2,807	¥(12)	¥(10,234)	¥1,499	¥10,561	¥584,802	
剰余金の配当	—	—	(23,102)	—	—	—	—	—	—	(23,102)	
当期純利益	—	—	36,726	—	—	—	—	—	—	36,726	
自己株式の取得	—	—	—	(12)	—	—	—	—	—	(12)	
自己株式の処分	—	(23)	(96)	748	—	—	—	—	—	629	
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	—	—	—	—	769	(39)	(924)	(342)	96	(440)	
2012年3月31日残高	¥54,961	¥78,023	¥471,186	¥(9,748)	¥3,576	¥(51)	¥(11,158)	¥1,157	¥10,657	¥598,603	
剰余金の配当	—	—	(9,317)	—	—	—	—	—	—	(9,317)	
当期純利益	—	—	6,076	—	—	—	—	—	—	6,076	
自己株式の取得	—	—	—	(15)	—	—	—	—	—	(15)	
自己株式の処分	—	—	(24)	174	—	—	—	—	—	150	
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	—	—	—	—	638	36	8,674	218	64	9,630	
2013年3月31日残高	¥54,961	¥78,023	¥467,921	¥(9,589)	¥4,214	¥(15)	¥(2,484)	¥1,375	¥10,721	¥605,127	

	千米ドル										
	株主資本				その他の包括利益累計額						純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	その他 有価証券 評価差額金	繰延 ヘッジ 損益	為替勘算 調整勘定	新株 予約権	少数株主 持分		
2012年3月31日残高	\$584,381	\$829,591	\$5,009,952	\$(103,647)	\$38,022	\$(542)	\$(118,639)	\$12,302	\$113,312	\$6,364,732	
剰余金の配当	—	—	(99,064)	—	—	—	—	—	—	(99,064)	
当期純利益	—	—	64,604	—	—	—	—	—	—	64,604	
自己株式の取得	—	—	—	(159)	—	—	—	—	—	(159)	
自己株式の処分	—	—	(255)	1,850	—	—	—	—	—	1,595	
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	—	—	—	—	6,783	383	92,227	2,318	680	102,391	
2013年3月31日残高	\$584,381	\$829,591	\$4,975,237	\$(101,956)	\$44,805	\$(159)	\$(26,412)	\$14,620	\$113,992	\$6,434,099	

連結財務諸表注記参照

## 連結キャッシュ・フロー計算書

東京エレクトロン株式会社及び連結子会社  
2013年3月期及び2012年3月期

	百万円		千米ドル
	2013	2012	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー：</b>			
税金等調整前当期純利益	¥ 17,767	¥ 60,602	\$ 188,910
減価償却費	26,631	24,198	283,158
のれん償却額	1,141	—	12,132
退職給付引当金の増加額	1,825	2,446	19,405
貸倒引当金の増加(減少)額	(2,167)	2,111	(23,041)
賞与引当金の減少額	(2,750)	(2,506)	(29,240)
製品保証引当金の増加(減少)額	(2,918)	1,343	(31,026)
受取利息及び受取配当金	(1,659)	(1,010)	(17,640)
受取手形及び売掛金の(増加)減少額	57,549	(15,540)	611,898
たな卸資産の減少額	20,279	16,023	215,619
未収消費税等の減少額	2,862	1,508	30,431
未払消費税等の増加(減少)額	596	(2,417)	6,337
支払手形及び買掛金の減少額	(15,482)	(5,807)	(164,615)
前受金の減少額	(12,456)	(4,567)	(132,440)
破産更生債権等の(増加)減少額	1,928	(1,890)	20,500
その他—純額	(2,726)	1,912	(28,984)
<b>小計</b>	<b>90,420</b>	<b>76,406</b>	<b>961,404</b>
利息及び配当金の受取額	1,587	978	16,874
利息の支払額	(68)	(43)	(723)
法人税等の支払額	(7,672)	(47,629)	(81,574)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>84,267</b>	<b>29,712</b>	<b>895,981</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー：</b>			
定期預金及び短期投資の預入等による支出	(192,057)	(284,500)	(2,042,073)
定期預金及び短期投資の払戻等による収入	126,000	315,500	1,339,713
有形固定資産の取得による支出	(19,012)	(36,010)	(202,148)
有形固定資産の売却による収入	3,630	1,102	38,596
無形固定資産の取得による支出	(1,234)	(2,140)	(13,121)
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出	(55,079)	(348)	(585,635)
事業譲受による支出	(1,097)	—	(11,664)
その他—純額	(2,920)	(1,956)	(31,047)
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(141,769)</b>	<b>(8,352)</b>	<b>(1,507,379)</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー：</b>			
短期借入金の純減少額	(646)	(3,594)	(6,869)
自己株式の純増加額	(15)	(12)	(159)
配当金の支払額	(9,317)	(23,102)	(99,064)
その他—純額	(647)	(627)	(6,880)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(10,625)</b>	<b>(27,335)</b>	<b>(112,972)</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	(5,335)	(300)	(56,725)
<b>現金及び現金同等物の減少額</b>	<b>(73,462)</b>	<b>(6,275)</b>	<b>(781,095)</b>
現金及び現金同等物期首残高	158,776	165,051	1,688,208
<b>現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>¥ 85,314</b>	<b>¥158,776</b>	<b>\$ 907,113</b>

連結財務諸表注記参照

## 連結財務諸表注記

東京エレクトロン株式会社及び連結子会社  
2013年3月期及び2012年3月期

### 1. 連結財務諸表作成の基本事項

添付の東京エレクトロン株式会社(以下「当社」)及び子会社(以下、総称として「東京エレクトロン」)の連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、金融商品取引法に基づく有価証券報告書に掲載された連結財務諸表に基づいて作成されております。我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準は、その適用及び開示に関して、国際財務報告基準とは異なっております。

当社は連結決算手続上必要とされる修正を勘案した上で、国際財務報告基準若しくは米国にて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成された在外子会社の財務諸表を利用して、連結財務諸表を作成しています。

また、添付の連結財務諸表は、我が国の法定連結財務諸表を再編成し、英訳したものであります。我が国の法定連結財務諸表に含まれる補足情報の一部は、添付の連結財務諸表に記載されておりません。

米国ドル金額は、読者の便宜のために、2013年3月期の期末日レートである1ドル=94.05円で換算しております。この換算は、円貨がそのレートで米国ドルに換金できることを意味しておりません。

### 2. 重要な会計方針

#### (a) 連結基準

本連結財務諸表は、2013年及び2012年期末における当社及び子会社それぞれ58社及び30社を連結対象としております。

連結会社間の重要な債権債務・内部取引・未実現損益は、全て消去されております。

また、連結子会社の事業年度は、19社を除き、当社の事業年度と一致しております。19社のうち、14社については、当該連結子会社の決算日である12月31日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。その他5社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

#### (b) 外貨換算

外貨建債権債務は、連結決算日の取引レートにより日本円に換算しており、その結果生じた換算差額は損益に含めております。ただし、為替予約が付されている外貨建債権債務等については、振当処理を行っております。

収益ならびに費用勘定は、概ね取引発生日の取引レートによって日本円に換算しております。

また、在外子会社の資産及び負債は、各期末日レートで日本円に換算しております。ただし、株主資本については、取得時レートによって換算しております。在外子会社の収益ならびに費用勘定は、期中平均レートにより換算しております。その結果生じた換算差額は、純資産の部のその他の包括利益累計額及び少数株主持分に表示されております。

#### (c) 現金及び現金同等物

現金及び現金同等物は、現預金及び取得時から3ヶ月以内に満期が到来する流動性の高い投資からなっております。

#### (d) 短期投資

短期投資は、満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び安全性の高い金融商品から構成されております。

#### (e) 投資有価証券

東京エレクトロンでは、その保有目的に応じて、投資有価証券を売買目的、満期保有目的、あるいはその他有価証券に分類しております。東京エレクトロンは、売買目的の有価証券は保有しておりません。なお、主として償却原価法にて満期保有目的の有価証券を計上しております。その他有価証券のうち、市場性のある有価証券は連結決算日における公正価値で評価され、未実現損益の変動は適用される税効果控除後の金額でその他の包括利益累計額として純資産の部に表示されております。その他有価証券のうち、市場性のない有価証券は、総平均法による原価法で評価されております。

売却された投資有価証券の原価は、総平均法により算定されております。

#### (f) たな卸資産

原材料以外のたな卸資産は、個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しており、原材料は、主として移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

#### (g) 有形固定資産

有形固定資産は、取得原価で表示されております。建物及び構築物、機械装置・運搬具及び工具器具備品の減価償却については、当社及び国内子会社は定率法で計算されております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法で計算されております。在外子会社の減価償却は、主として定額法で計算されております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物	2～60年
機械装置・運搬具及び工具器具備品	2～17年

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内子会社は、法人税法の改正に伴い、2013年3月期より、2012年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

#### (h) 無形固定資産

無形固定資産は、定額法によって償却しております。

#### (i) のれん

のれんは、個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数で均等償却しております。

#### (j) 固定資産の減損

東京エレクトロンは、事業の用に供している固定資産の帳簿価額の評価を実施しています。

固定資産帳簿価額の減損が認められた場合、帳簿価額が売却価値と使用価値のいずれか高い方である回収可能価額を超えた額を損失として認識します。売却価値は公正価額から処分費用を減額した金額、使用価値は個々の資産または資産グループの継続的使用及び使用後の処分から得られる将来キャッシュ・フローの割引現在価値の金額によってそれぞれ算定されます。

#### (k) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (l) 退職給付引当金

当社及び国内子会社は、従業員の退職給付に備えるため、退職給付債務の見込額及び年金資産の公正価値に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。過去勤務債務は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を費用処理しております。また、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

当社及び国内子会社は、従業員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

なお、当社及び一部国内子会社は、2005年3月末日をもって役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。これに伴い、2005年6月開催の定時株主総会において、各役員の時任時から2005年3月末日までの在任期間に対応する退職慰労金を各役員の退任時に支給することを決議し、支給する金額及び方法等については、取締役については取締役会に、監査役については監査役

の協議に一任したため、当該支給見込額を引当計上しております。注記11に記載のとおり、役員退職慰労引当金は、連結貸借対照表上の退職給付引当金に含まれます。

#### (m) 製品保証引当金

東京エレクトロンの製品は通常製品保証が付されており、製品保証期間中のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、過去の支出実績に基づき将来の支出見込額を、収益認識時に計上しております。

#### (n) リース

2008年3月期以前は、当社及び国内子会社は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ、オペレーティング・リースとして会計処理しておりました。

2009年3月期より、当社及び国内子会社は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第13号)、及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第16号)を適用しております。その結果、当社及び国内子会社は2008年4月1日以後に開始したファイナンス・リース取引については、リース資産として計上し、当該リース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

#### (o) デリバティブ及びヘッジ会計

当社及び一部国内子会社が利用しているデリバティブ取引は、為替変動によるリスクの回避を目的として、外貨建取引の成約高の範囲に限られており、投機的な取引は行っておりません。

デリバティブ金融商品は連結貸借対照表上公正価値で評価され、未実現損益の変動は繰延ヘッジ会計の要件を満たす場合を除いては利益又は損失として計上されております。税効果控除後の繰延ヘッジ損益は、純資産の部のその他包括利益累計額に表示されております。ヘッジ会計の要件を満たした外国為替先物予約契約によりヘッジされている受取債権及び支払債務は、当該予約レートで換算されております。

#### (p) 法人税等

東京エレクトロンは、資産及び負債の財務報告上の金額と税務上の評価額との差額について繰延税金資産及び負債を認識しており、それらは当該差額が解消すると期待される時点で適用される税率と税法を用いて計算されております。

#### (q) 収益の計上基準

半導体製造装置及びFPD(Flat Panel Display) / PV(Photovoltaic panel)製造装置の収益の計上基準については、原則として設置完了基準によっております。重要な据付作業を要

## 連結財務諸表注記

さない装置については、出荷基準によって収益を認識しております。電子部品を含むその他の製品については、出荷基準によって収益を認識しております。有償保守サービスについては、メンテナンス契約期間にわたって収益を認識しております。

## (r) 1株当たり情報

1株当たり当期純利益及び純資産額は、各年の加重平均株式数に基づき計算されております。

1株当たり配当額は、3月31日に終了する決算期に係る配当金を発生主義に基づき計算しており、3月31日以降に決議された配当金を含んでおります。

## (s) 研究開発費

研究開発費は、発生時に費用として処理しております。2013年及び2012年3月期の研究開発費は、それぞれ73,249百万円(778,830千米ドル)及び81,506百万円となっております。

## (t) 組替表示

過年度の連結財務諸表は、2013年3月期の表示に合わせて組替表示されております。

## 3. 会計方針の変更

## (a) 1株当たり当期純利益に関する会計基準

2012年3月期より、当社は、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第2号 2010年6月30日)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第4号 2010年6月30日公表分)を適用しております。潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業に提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。

## (b) 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

2012年3月期以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、当社及び国内子会社は、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第24号)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第24号)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。

## 4. 未適用の会計基準等

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第26号 2012年5月17日)

「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第25号 2012年5月17日)

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものであります。

本会計基準等は、2014年3月期の期末より適用予定であります。退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、2015年3月期の期首より適用予定であります。

なお、本会計基準等の適用による影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

## 5. 連結キャッシュ・フロー計算書情報

2013年3月期における株式の取得により新たに連結子会社となった会社の連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は、次のとおりであります。

	百万円		千米ドル	
	2013	2013	2013	2013
流動資産	¥21,811	\$231,909		
固定資産	31,585	335,832		
のれん	35,110	373,312		
流動負債	(16,860)	(179,266)		
固定負債	(30,544)	(324,764)		
株式の取得価額	41,102	437,023		
前連結会計年度における支出	(348)	(3,700)		
現金及び現金同等物	(9,552)	(101,563)		
取得日時点における貸付金	23,877	253,875		
差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出	¥55,079	\$585,635		

## 6. 有価証券

2013年及び2012年3月31日現在の投資有価証券のうち、その他有価証券の内訳は次のとおりであります。

2013:	百万円	
	取得原価	連結貸借対照表計上額
固定資産		
時価のあるもの		
株式	¥10,218	¥16,631
時価のないもの		
非上場株式	793	897
その他	1,141	1,141
合計	¥12,152	¥18,669

2012:	百万円	
	取得原価	連結貸借対照表計上額
固定資産		
時価のあるもの		
株式	¥ 9,212	¥14,699
時価のないもの		
非上場株式	485	473
その他	910	910
合計	¥10,607	¥16,082

2013:	千米ドル	
	取得原価	連結貸借対照表計上額
固定資産		
時価のあるもの		
株式	\$108,644	\$176,831
時価のないもの		
非上場株式	8,432	9,538
その他	12,132	12,132
合計	\$129,208	\$198,501

2013年及び2012年3月31日現在において流動資産に区分されている満期保有目的の債券は、それぞれ190,498百万円(2,025,497千米ドル)及び211,790百万円であります。

2013年及び2012年3月期における連結貸借対照表上の短期投資と満期保有目的の債券との差額は、次のとおりであります。

	百万円		千米ドル	
	2013	2012	2013	2013
満期保有目的債券(流動)	¥190,498	¥211,790	\$2,025,497	
満期日又は償還日までの期間が3ヶ月以内の安全性の高い金融商品	(45,498)	(132,790)	(483,764)	
満期日までの期間が3ヶ月超の定期預金	9,816	9,849	104,370	
短期投資	¥154,816	¥ 88,849	\$1,646,103	

2013年及び2012年3月期における投資有価証券評価損は、それぞれ44百万円(468千米ドル)及び817百万円であります。

2013年3月期における投資有価証券売却益はありません。2012年3月期における投資有価証券売却益は、38百万円であります。

## 7. たな卸資産

2013年及び2012年3月31日現在のたな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

	百万円		千米ドル	
	2013	2012	2013	2013
製品	¥ 87,398	¥101,790	\$ 929,272	
仕掛品・原材料・貯蔵品	48,300	47,680	513,556	
合計	¥135,698	¥149,470	\$1,442,828	

2013年及び2012年3月期の連結損益計算書の「売上原価」には、たな卸資産評価損がそれぞれ1,162百万円(12,355千米ドル)及び1,115百万円含まれています。

## 8. 固定資産の減損

固定資産の減損損失認識の判定においては、原則として、事業用資産については損益管理を合理的に行える事業単位を基礎とした区分に基づき資産のグルーピングを行っております。また、非事業用資産及び遊休資産については、個別に回収可能性の評価を実施しております。

2013年及び2012年3月期における減損損失は、軽微であります。

## 9. 担保提供資産

2013年及び2012年3月31日現在、東京エレクトロンが担保に供している資産はありません。

## 10. 短期借入金

2013年及び2012年3月31日現在の流動負債に含まれる短期借入金は、それぞれ3,756百万円(39,936千米ドル)及び4,403百万円であります。これらは銀行からの借入であり、2013年及び2012年3月31日現在の平均利率は、それぞれ0.50%及び0.40%であります。

2013年3月31日現在における当座貸越契約及び貸出コミットメントの残高は151,885百万円(1,614,939千米ドル)であります。

## 11. 退職給付引当金

当社及び国内子会社は、大多数の従業員を対象として、確定給付年金制度(キャッシュバランスプラン及び非拠出制の退職給付

## 連結財務諸表注記

一時金制度)を設けております。これらの制度において、給付金額は勤務期間及びその他の事由に基づいて決定されております。

キャッシュバランスプランにおいて、従業員は解雇以外の事由で退職した場合、年金あるいは一時金を受給します。キャッシュバランスプランのもとでは、対象者の個人別仮想口座において、毎年の掛金及び市場連動金利に基づいた給付額が計算されて積み立てられます。非拠出制の退職一時金制度においては、解雇以外の事由で退職した従業員が一時金を受給します。一部の海外子会社は、非拠出制の退職給付一時金制度を採用しており、解雇以外の事由で退職した従業員は、年金あるいは一時金を受給します。

2013年及び2012年3月31日現在の退職給付債務に関する事項は、次のとおりであります。

	百万円		千米ドル
	2013	2012	2013
退職給付債務	¥(106,972)	¥(94,369)	\$ (1,137,395)
年金資産	52,152	45,139	554,514
未積立退職給付債務	(54,820)	(49,230)	(582,881)
未認識数理計算上の差異	1,150	(1,809)	12,227
純額	(53,670)	(51,039)	(570,654)
連結貸借対照表計上額			
前払年金費用(注1)	2,974	3,607	31,621
退職給付引当金(注2)	(56,644)	(54,646)	(602,275)
純額	¥ (53,670)	¥(51,039)	\$ (570,654)

注：1. 2013年及び2012年3月期の前払年金費用は、連結貸借対照表の「その他資産」に含まれております。  
2. 役員退職慰労引当金(2013年：581百万円(6,178千米ドル)、2012年：620百万円)は含まれておりません。

退職給付費用に関する事項は、次のとおりであります。

	百万円		千米ドル
	2013	2012	2013
勤務費用	¥5,513	¥5,597	\$58,618
利息費用	1,864	1,768	19,819
期待運用収益	(887)	(814)	(9,431)
数理計算上の差異の費用処理額	(501)	401	(5,327)
過去勤務債務の費用処理額	—	25	—
合計	¥5,989	¥6,977	\$63,679

退職給付債務等の計算の基礎に関する事項は、次のとおりであります。

	2013	2012
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	期間定額基準
割引率	1.40%	2.00%
期待運用収益率	2.00%	2.00%
数理計算上の差異の処理年数	4年	4年
過去勤務債務の額の処理年数	4年	4年

## 12. 法人税等

2013年及び2012年3月31日現在の東京エレクトロンの繰延税金資産・負債の主な内訳は、次のとおりであります。

	百万円		千米ドル
	2013	2012	2013
<b>繰延税金資産</b>			
退職給付引当金	¥20,326	¥19,538	\$216,119
税務上の繰越欠損金	15,864	1,609	168,676
試験研究費の繰越税額控除	6,811	12,564	72,419
たな卸資産評価損	4,666	4,749	49,612
たな卸資産に係る未実現利益	2,967	9,161	31,547
賞与引当金	2,202	2,954	23,413
製品保証引当金	1,875	2,971	19,936
その他	8,593	8,029	91,367
繰延税金資産小計	63,304	61,575	673,089
評価性引当額	(13,352)	(15,134)	(141,967)
繰延税金資産合計	49,952	46,441	531,122
<b>繰延税金負債</b>			
企業結合により識別された無形資産	(6,110)	—	(64,966)
在外子会社の留保利益	(4,789)	(3,760)	(50,920)
その他有価証券評価差額金	(2,341)	(1,981)	(24,891)
特別償却準備金	(1,058)	(1,084)	(11,249)
前払年金費用	(1,051)	(1,200)	(11,175)
その他	(547)	(748)	(5,816)
繰延税金負債合計	(15,896)	(8,773)	(169,017)
繰延税金資産の純額	¥34,056	¥37,668	\$ (362,105)

2013年及び2012年3月期の繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	百万円		千米ドル
	2013	2012	2013
流動資産-繰延税金資産	¥15,669	¥23,546	\$166,603
固定資産-繰延税金資産	23,206	17,585	246,741
流動負債-その他	(2)	(1)	(21)
固定負債-その他	(4,817)	(3,462)	(51,218)

繰延税金資産の回収可能性は、将来減算一時差異の解消が予定される期間の将来課税所得の水準に依存しております。繰延税金資産の回収可能性の判断において、経営者は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて、予定される繰延税金負債の戻入、将来の課税所得の見通し、税務戦略及び税務上の繰越欠損金の推移等を考慮しております。

経営者は、2013年及び2012年3月31日時点の東京エレクトロンの評価性引当額控除後の繰延税金資産に対して、過去の課税所得や、繰延税金資産が控除可能な期間における将来の課税所得を踏まえ、回収可能であると判断しております。

当社及び国内全額出資子会社は、連結納税制度を適用しております。

法人税、住民税、事業税を合計した2013年及び2012年3月期における当社の法定実効税率は、それぞれ38.01%及び40.69%となっております。2011年12月2日付で税制改正が公表されたことに伴い、法定実効税率は2012年4月1日から2015年3月31日までのものは38.01%、2015年4月1日以降については35.64%にそれぞれ変更されております。当該税制改正に基づき、当社及び国内子会社の2013年3月31日現在の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、回収又は支払が見込まれる期間が2013年4月1日から2015年3月31日までのものは38.01%、2015年4月1日以降のものについては35.64%であります。

2013年及び2012年3月期における東京エレクトロンの法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳は、次のとおりであります。

	2013	2012
国内の法定実効税率(調整)	38.01%	40.69%
未実現利益消去による影響額	16.70	(0.16)
過年度法人税等	12.35	—
税率差異による差額	(7.12)	(4.04)
在外子会社の留保利益	5.63	0.87
税額控除等	(3.65)	(5.20)
未認識税効果の影響額	(2.44)	0.38
のれんの償却額	2.14	—
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.14	0.82
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	—	5.92
その他	1.45	(0.63)
税効果会計適用後の法人税等の負担率	64.21%	38.65%

当社は、2006年3月期から2011年3月期までの6年間における当社と米国及び韓国の子会社との取引について、2012年7月4日付で東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を受領しました。

当社はこの処分を不服として当局に対し異議申立書を提出し、この更正処分により生じている二重課税を排除するため、2013年3月29日に租税条約に基づく相互協議の申し立てを国税庁に対し行いました。併せてその後の年度について東京国税局に対し事前確認申請(APA)を行っております。

なお、相互協議により、二重課税の排除が見込まれるため、過年度法人税等には両国との法人税率差による差額及び追加納税に伴う付帯税額の合計額2,195百万円(23,339千米ドル)を計上しております。

## 13. 純資産

純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、新株予約権及び少数株主持分の4区分で構成されております。

我が国の法令及び規則のもとでは、新株の払込金の全額を資本金とすることが求められておりますが、取締役会決議により、発行価額の50%を超えない金額を資本剰余金に含まれる資本準備金に組み入れることも認められております。

剰余金の配当を行う場合、資本金の25%に相当する額が資本準備金及び利益準備金の合計額を超える時は、その超過額または配当の10%に相当する額のうちいずれか少ない方の金額を、資本準備金あるいは利益準備金として計上することが要求されております。利益準備金は、連結財務諸表上、利益剰余金に含まれております。

また、原則として、利益準備金及び資本準備金を欠損金の填補に使用するためには、いずれも株主総会の決議を要します。

資本準備金及び利益準備金から配当を実施することはできません。全ての資本準備金と利益準備金はそれぞれその他資本剰余金とその他利益剰余金に振り替えることができ、これらを配当に使用することができます。

なお、当社は連結配当規制適用会社であります。

当社は、法令及び規則に従い、取締役会の決議により中間配当と期末配当以外にも配当を実施することができる旨の定めを定款に設けております。

2013年5月15日開催の取締役会において、4,659百万円(49,537千米ドル)の配当の実施が決議されました。この配当は、2013年3月31日現在の連結財務諸表には計上されておらず、当該取締役会決議日が属する事業年度において計上されます。

## 連結財務諸表注記

## 14. その他包括利益

2013年及び2012年3月期におけるその他包括利益の内訳は、次のとおりであります。

	百万円		千米ドル
	2013	2012	2013
その他有価証券評価差額金			
当期発生額	¥1,011	¥ 302	\$ 10,750
組換調整額	—	531	—
税効果調整前	1,011	833	10,750
税効果額	(359)	(64)	(3,817)
その他有価証券評価差額金	652	769	6,933
繰延ヘッジ損益			
当期発生額	(339)	(9)	(3,604)
組換調整額	431	(101)	4,582
税効果調整前	92	(110)	978
税効果額	(36)	41	(383)
繰延ヘッジ損益	56	(69)	595
為替換算調整勘定			
当期発生額	8,760	(925)	93,142
組換調整額	—	—	—
税効果調整前	8,760	(925)	93,142
税効果額	—	—	—
為替換算調整勘定	8,760	(925)	93,142
その他の包括利益(損失)合計	¥9,468	¥(225)	\$100,670

## 15. 株式報酬制度

## ストック・オプション制度

東京エレクトロンでは、1999年3月に終了した年度より、役員及び幹部従業員へのストック・オプション制度を採用しております。この制度において付与されたストック・オプションの行使期間は、付与後8年から20年ですが、付与後2年間または3年間の行使は制限されております。

2013年及び2012年3月期には、130,700株及び234,200株

2013年及び2012年3月31日時点のストック・オプション残高及び行使可能残高の概要は、次のとおりであります。

東京エレクトロン(株)	2013			2012	
	株数	加重平均行使価格		株数	加重平均行使価格
		円	ドル		円
期首残高	833,300	¥3,139	\$33.38	1,296,800	¥5,086
付与	130,700	1	0.01	234,200	1
行使	25,800	1	0.01	111,100	1
失効	381,300	5,894	62.67	586,600	6,786
期末残高	556,900	661	7.03	833,300	3,139
行使可能残高	192,000	1,914	20.35	599,100	4,365

が株主総会決議のもと、1円の行使価格にてそれぞれ付与されております。この制度において付与されたストック・オプションの行使期間は付与後20年ですが、付与後3年間の行使は制限されております。

国内上場子会社である東京エレクトロンデバイス(株)は、2005年3月期より役員及び幹部従業員に対するストック・オプション制度を採用しております。

## 東京エレクトロンデバイス(株)

	2013			2012	
	株数	加重平均行使価格		株数	加重平均行使価格
		円	ドル		円
期首残高	650	¥308,698	\$3,282.28	650	¥308,698
付与	—	—	—	—	—
行使	—	—	—	—	—
失効	—	—	—	—	—
期末残高	650	308,698	3,282.28	650	308,698
行使可能残高	650	308,698	3,282.28	650	308,698

## 16. リース

注記2(n)に記載のとおり、2009年3月期より、当社及び国内子会社は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第13号)、及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第16号)を適用しております。当基準においては、2008年3月期以前に開始されたファイナンス・リースは、継続して通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によることが認められております。2008年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては、キャピタル・リースとして処理した場合における取得価額、減価償却累計額、リース債務及び減価償却費の予測数値は、2013年及び2012年3月期それぞれ、次のとおりであります。

連結貸借対照表に記載されていないリース資産：

	百万円		千米ドル
	2013	2012	2013
取得価額相当額	¥286	¥286	\$3,041
減価償却累計額相当額	264	216	2,807
期末残高相当額	¥ 22	¥ 70	\$ 234

当該所有権移転外ファイナンス・リースに係る未経過リース料：

	百万円		千米ドル
	2013	2012	2013
1年内	¥22	¥48	\$234
1年超	—	22	—
合計	¥22	¥70	\$234

オペレーティング・リースとして処理されたファイナンス・リースに関わるリース支払額は、それぞれのリース資産のリース期間にて定額法で計算した減価償却費相当額と概ね同額であると想定され、2013年及び2012年3月期における総額は、それぞれ48百万円(510千米ドル)及び97百万円です。

オペレーティング・リースに係る未経過リース料：

	百万円		千米ドル
	2013	2012	2013
1年内	¥1,628	¥2,013	\$17,310
1年超	2,834	2,905	30,133
合計	¥4,462	¥4,918	\$47,443

## 17. 金融商品

## 金融商品に対する取組方針及びリスク管理体制

東京エレクトロンは、資金運用については短期的な預金並びに安全性の高い金融商品に限定し、また、資金調達については主に銀行借入や売掛債権流動化によっております。

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、当社の社内規程である「信用限度規程」に従い、取引先ごとの与信枠の管理を行うとともに、債権期日管理及び残高管理を行っております。また、主な取引先の信用状況については、定期的に把握しております。

短期投資は、定期預金及び安全性の高い金融商品から構成されており、信用リスクを軽減するため格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

投資有価証券は、主に上場株式であるため市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価等の状況を把握しております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

デリバティブ取引については、注記18を参照ください。

## 連結財務諸表注記

## 金融商品の時価等に関する事項

2013年及び2012年3月31日における連結貸借対照表計上額及び時価については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません(注記6を参照ください)。

2013:	百万円	
	連結対照表計上額	時価 <sup>1)</sup>
資産		
現金及び現金同等物	¥ 85,314	¥ 85,314
短期投資	154,816	154,811
受取手形及び売掛金 - 貸倒引当金(1,180百万円)控除後	99,321	99,321
投資有価証券	16,631	16,631
負債		
支払手形及び買掛金	36,261	36,261
デリバティブ取引(注記18参照)		
ヘッジ会計が適用されていないもの	(3,325)	(3,325)
ヘッジ会計が適用されているもの	(62)	(62)

2012:	百万円	
	連結対照表計上額	時価 <sup>1)</sup>
資産		
現金及び現金同等物	¥158,776	¥158,776
短期投資	88,849	88,638
受取手形及び売掛金 - 貸倒引当金(1,376百万円)控除後	148,930	148,930
投資有価証券	14,699	14,699
負債		
支払手形及び買掛金等	46,987	46,987
デリバティブ取引(注記18参照)		
ヘッジ会計が適用されていないもの	(400)	(400)
ヘッジ会計が適用されているもの	(153)	(153)

2013:	千米ドル	
	連結対照表計上額	時価 <sup>1)</sup>
資産		
現金及び現金同等物	\$ 907,113	\$ 907,113
短期投資	1,646,103	1,646,050
受取手形及び売掛金 - 貸倒引当金(12,546千米ドル)控除後	1,056,045	1,056,045
投資有価証券	176,831	176,831
負債		
支払手形及び買掛金	385,550	385,550
デリバティブ取引(注記18参照)		
ヘッジ会計が適用されていないもの	(35,354)	(35,354)
ヘッジ会計が適用されているもの	(659)	(659)

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。

注: 1. 金融商品の時価の算定方法及び短期投資及びデリバティブ取引に関する事項  
現金及び現金同等物、短期投資、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金  
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。  
投資有価証券  
市場のある投資有価証券の時価は、取引所の価格によっております。  
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、注記6を参照ください。  
デリバティブ取引  
注記18を参照ください。

## 2. 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2013:	百万円	
	1年以内	1年超5年以内
現金及び現金同等物	¥ 85,314	¥—
短期投資	154,816	—
受取手形及び売掛金	100,501	—

2012:	百万円	
	1年以内	1年超5年以内
現金及び現金同等物	¥158,776	¥—
短期投資	88,849	—
受取手形及び売掛金	150,306	—

2013:	千米ドル	
	1年以内	1年超5年以内
現金及び現金同等物	\$ 907,113	\$—
短期投資	1,646,103	—
受取手形及び売掛金	1,068,591	—

## 18. デリバティブ

東京エレクトロンは、通常の営業活動に伴う外貨建取引及び財務活動に伴う外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避する目的で、先物為替予約取引を利用しておりますが、投機的な目的での取引は行っておりません。当社及び一部国内子会社は、キャッシュ・フロー変動の累計額を比率分析しております。なお、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定できる場合は、有効性の判定を省略しております。先物為替予約取引の実行及び管理は、社内規程である「金融市場リスク管理規程」に基づき、財務担当部署が行っております。

2013年及び2012年3月31日現在のデリバティブの公正価額は、次のとおりであります。

## 1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2013:	百万円		
	契約額	時価	評価損益
売建 米ドル	¥50,652	¥(3,021)	¥(3,021)
売建 スイスフラン	25,787	(50)	(50)
売建 韓国ウォン	1,068	(295)	(295)
売建 シンガポールドル	50	(3)	(3)
買建 米ドル	4,368	44	44
合計	¥81,925	¥(3,325)	¥(3,325)

2012:	百万円		
	契約額	時価	評価損益
売建 米ドル	¥ 9,874	¥(464)	¥(464)
売建 韓国ウォン	701	23	23
買建 米ドル	5,804	41	41
合計	¥16,379	¥(400)	¥(400)

2013:	千米ドル		
	契約額	時価	評価損益
売建 米ドル	\$538,564	\$(32,121)	\$(32,121)
売建 スイスフラン	274,184	(532)	(532)
売建 韓国ウォン	11,356	(3,137)	(3,137)
売建 シンガポールドル	532	(32)	(32)
買建 米ドル	46,443	468	468
合計	\$871,079	\$(35,354)	\$(35,354)

注: 時価の算定方法は先物為替相場によっております。

## 2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

2013: 繰延ヘッジ処理	百万円		千米ドル	
	契約額	時価	契約額	時価
売建 米ドル	¥ 5,872	¥(90)	\$ 62,435	\$(957)
売建 人民元	290	(3)	3,083	(32)
売建 韓国ウォン	157	(42)	1,669	(447)
売建 スイスフラン	60	1	638	11
売建 ユーロ	22	(2)	234	(21)
買建 米ドル	6,180	33	65,710	351
買建 ユーロ	769	41	8,177	436
合計	¥13,350	¥(62)	\$141,946	\$(659)

2012: 繰延ヘッジ処理	百万円	
	契約額	時価
売建 米ドル	¥6,879	¥(181)
売建 韓国ウォン	85	(7)
売建 人民元	192	1
買建 米ドル	4,325	17
買建 ユーロ	195	17
合計	¥11,676	¥(153)

先物為替予約取引の契約額は、外貨建受取債権及び支払債務をヘッジするために行われ、連結貸借対照表において当該債権債務が予約レートで換算されているものは、次のとおりであります。

	時価		
	百万円	2012	千米ドル 2013
売建 人民元	¥ 9,760	¥9,854	\$103,775
売建 米ドル	404	58	4,295
買建 米ドル	74	65	787
合計	¥10,238	¥9,977	\$108,857

注: 時価の算定方法は先物為替相場によっており、外貨建債権債務等に振り当てたデリバティブ取引については、ヘッジ対象と一体として処理されているため、当該デリバティブ取引の時価はヘッジ対象の時価に含めて記載しております。

## 19. その他収益(費用)

2012年3月期における災害による損失936百万円は、2011年3月11日に発生した東日本大震災に関連する費用であり、主に被災地施設の復旧工事費用であります。

2012年3月期における事業再編損失849百万円は、事業の再編に伴う資産評価減及び処分等の費用であります。

## 20. 企業結合

## 取得による企業結合

## (A) NEXX Systems, Inc. の株式取得

## (1) 企業結合の概要

## (a) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 NEXX Systems, Inc.

事業内容 半導体製造装置(ウェーハレベル・パッケージング向けめっき装置及びスパッタリング装置)の開発・製造

## (b) 企業結合を行った主な理由

NEXX Systems社の先進的パッケージングアプリケーションを獲得することで事業参入領域を拡大し、当社グループの半導体製造装置事業を強化するためであります。

## (c) 企業結合日

2012年5月1日

## (d) 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式の取得

## (e) 結合後企業の名称

TEL NEXX, Inc.

## (f) 取得した議決権比率

100%

## (g) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社の連結子会社であるTokyo Electron U.S. Holdings, Inc.による現金を対価とする株式取得のため

## (2) 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

2012年5月1日から2013年3月31日まで

## (3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

	百万円	千米ドル
取得の対価	¥15,961	\$169,708
取得原価	¥15,961	\$169,708

## (4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

## (a) 発生したのれん金額

8,379百万円(89,091千米ドル)

## (b) 発生原因

今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。

## (c) 償却方法及び償却期間

10年間にわたる均等償却



## 連結財務諸表注記

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

	百万円	千米ドル
流動資産	¥ 2,183	\$ 23,211
固定資産	10,702	11,791
資産合計	¥12,885	\$137,002

	百万円	千米ドル
流動負債	¥1,659	\$17,640
固定負債	3,644	38,745
負債合計	¥5,303	\$56,385

(6) 企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

	百万円	千米ドル
売上高	¥415	\$4,413
営業利益	(259)	(2,754)
税金等調整前当期純利益	(303)	(3,222)

(概算額の算定方法)

企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定した売上高及び損益情報と取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を影響の概算額としております。また、当該差額に当連結会計年度の開始の日から企業結合日までの期間に相当するのれん等の無形固定資産の償却額を含めております。

なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。

## (B) FSI International, Inc. の株式取得

## (1) 企業結合の概要

(a) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 FSI International, Inc.

事業内容 半導体製造装置(洗浄装置)の開発・製造

(b) 企業結合を行った主な理由

FSI International社の製品群を当社グループの洗浄装置事業に加えることによって、ポートフォリオを拡充し、洗浄装置事業を強化するためであります。

(c) 企業結合日

2012年10月11日

(d) 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式の取得

(e) 結合後企業の名称

TEL FSI, Inc.

(f) 取得した議決権比率

100%

(g) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社の連結子会社である Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc. による現金を対価とする株式取得のため

(2) 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

2012年10月11日から2013年3月31日まで

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

	百万円	千米ドル
取得の対価	¥19,772	\$210,229
取得原価	¥19,772	\$210,229

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(a) 発生したのれん

3,856百万円(40,999千米ドル)

なお、企業結合日における識別可能な資産及び負債の特定並びに時価の算定が未了であるため、取得原価の配分が完了しておりません。そのため、のれん

の金額は、暫定的に算定しております。

(b) 発生原因

受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額をのれんとして処理しております。

(c) 償却方法及び償却期間

効果の発現する期間にわたって均等償却します。

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

	百万円	千米ドル
流動資産	¥ 8,446	\$ 89,803
固定資産	12,461	132,494
資産合計	¥20,907	\$222,297

	百万円	千米ドル
流動負債	¥2,457	\$26,125
固定負債	2,534	26,943
負債合計	¥4,991	\$53,068

(6) 企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

	百万円	千米ドル
売上高	¥6,697	\$71,207
営業利益	70	744
税金等調整前当期純利益	21	223

(概算額の算定方法)

企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定した売上高及び損益情報と取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を影響の概算額としております。

また、当該差額に当連結会計年度の開始の日から企業結合日までの期間に相当するのれん等の無形固定資産の償却額を含めております。

なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。

## (C) Magnetic Solutions Ltd. の株式取得

(1) 企業結合の概要

(a) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 Magnetic Solutions Ltd.

事業内容 磁場中熱処理装置の開発・製造

(b) 企業結合を行った主な理由

将来のキーデバイスとして注目されるMRAM(磁気メモリ)製造用の熱処理装置開発を進めるために、Magnetic Solutions社の強磁場熱処理技術を獲得し、当社技術と組み合わせることにより、当社グループの熱処理装置事業を強化するためであります。

(c) 企業結合日

2012年12月3日

(d) 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式の取得

(e) 結合後企業の名称

TEL Magnetic Solutions Ltd.

(f) 取得した議決権比率

100%

(g) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社の連結子会社である Tokyo Electron Europe Ltd. による現金を対価とする株式取得のため

(2) 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

2012年12月3日から2013年3月31日まで

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

	百万円	千米ドル
取得の対価	¥2,065	\$21,956
取得原価	¥2,065	\$21,956

(4) 発生したのれん

(a) 発生したのれん

1,089百万円(11,579千米ドル)

(b) 発生原因

今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。

(c) 償却方法及び償却期間

10年間にわたる均等償却

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

	百万円	千米ドル
流動資産	¥ 560	\$ 5,954
固定資産	971	10,325
資産合計	¥1,531	\$16,279

	百万円	千米ドル
流動負債	¥555	\$5,901
固定負債	—	—
負債合計	¥555	\$5,901

(6) 企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

	百万円	千米ドル
売上高	¥1,068	\$11,356
営業利益	93	989
税金等調整前当期純利益	89	946

(概算額の算定方法)

企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定した売上高及び損益情報と取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を影響の概算額としております。また、当該差額に当連結会計年度の開始の日から企業結合日までの期間に相当するのれん等の無形固定資産の償却額を含めております。

なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。

## (D) Oerlikon Solar Holding AG の株式取得

(1) 企業結合の概要

(a) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 Oerlikon Solar Holding AG

事業内容 薄膜シリコン太陽光パネル用製造装置の開発・製造

(b) 企業結合を行った主な理由

太陽光パネル製造装置事業を発展させるため、薄膜シリコン太陽光パネル製造装置で実績のあるOerlikon Solar社を企業買収し、同社の薄膜成膜技術と当社グループが培ってきた製造装置技術を融合させることにより、同事業を強化するためであります。

(c) 企業結合日

2012年11月26日

(d) 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式の取得

## 連結財務諸表注記

(e) 結合後企業の名称  
TEL Solar Holding AG

(f) 取得した議決権比率  
100%

(g) 取得企業を決定するに至った主な根拠  
当社による現金を対価とする株式取得のため

(2) 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間  
被取得企業の決算日は12月31日であり、みなし取得日を2012年12月31日としているため、当連結会計年度には被取得企業の業績は含まれておりません。

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

	百万円	千米ドル
取得の対価	¥2,837	\$30,165
取得に直接要した費用	468	4,976
取得原価	¥3,305	\$35,141

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(a) 発生したのれん

21,787百万円(231,653千米ドル)

なお、企業結合日における識別可能な資産及び負債の特定並びに時価の算定が未了であるため、取得原価の配分が完了しておりません。そのため、のれん

の金額は、暫定的に算定しております。

(b) 発生原因

受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額をのれんとして処理しております。

(c) 償却方法及び償却期間

効果の発現する期間にわたって均等償却します。

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

	百万円	千米ドル
流動資産	¥10,622	\$112,940
固定資産	7,451	79,224
資産合計	¥18,073	\$192,164

	百万円	千米ドル
流動負債	¥12,189	\$129,601
固定負債	24,366	259,075
負債合計	¥36,555	\$388,676

(6) 企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

	百万円	千米ドル
売上高	¥ 6,358	\$ 67,602
営業利益	(12,280)	(130,569)
税金等調整前当期純利益	(13,208)	(140,436)

(概算額の算定方法)

企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定し、被取得企業の平成2012年1月1日から平成2012年12月31日の業績を基礎とし、のれんの償却額を加味して算定した売上高及び損益情報を影響の概算額としております。

なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。

## 21. セグメント情報

## 報告セグメントの概要

東京エレクトロンの報告セグメントは、東京エレクトロンの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

東京エレクトロンは、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」、「FPD/PV(フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル)製造装置」及び「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハブローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD/PV製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置及び薄膜シリコン太陽光パネル用製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「電子部品・情報通信機器」は、集積回路(IC)を中心とした半導体製品、その他電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア等の設計・開発・仕入・販売等を行っております。

## 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表の作成方法と概ね同一であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。また、共用資産については、各報告セグメントに配分しておりませんが、関連する費用については、合理的な基準に基づき各報告セグメントに配分しております。

## 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

2013年及び2012年3月期の報告セグメント情報は、次のとおりであります。

	百万円						
	報告セグメント			その他	合計	調整額	連結財務諸表計上額
	半導体製造装置	FPD/PV製造装置	電子部品・情報通信機器				
2013:							
売上高							
外部顧客への売上高	¥392,027	¥20,160	¥84,665	¥ 448	¥497,300	¥ —	¥497,300
セグメント間の内部売上高又は振替高	43	—	813	10,613	11,469	(11,469)	—
計	392,070	20,160	85,478	11,061	508,769	(11,469)	497,300
セグメント利益又は損失	48,600	(6,355)	1,283	1,321	44,849	(27,082)	17,767
セグメント資産	223,956	49,489	47,557	1,550	322,552	452,976	775,528
減価償却費	12,330	462	448	78	13,318	13,313	26,631
のれんの償却額	1,038	—	103	—	1,141	—	1,141
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	13,464	1,661	482	54	15,661	9,834	25,495

	百万円						
	報告セグメント			その他	合計	調整額	連結財務諸表計上額
	半導体製造装置	FPD/PV製造装置	電子部品・情報通信機器				
2012:							
売上高							
外部顧客への売上高	¥477,873	¥69,889	¥84,868	¥ 461	¥633,091	¥ —	¥633,091
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	1,432	14,565	15,997	(15,997)	—
計	477,873	69,889	86,300	15,026	649,088	(15,997)	633,091
セグメント利益	89,020	2,271	2,312	1,827	95,430	(34,828)	60,602
セグメント資産	262,789	21,295	46,391	1,927	332,402	451,209	783,611
減価償却費	11,282	687	570	170	12,709	11,489	24,198
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	13,518	672	407	36	14,633	28,572	43,205

	千米ドル						
	報告セグメント			その他	合計	調整額	連結財務諸表計上額
	半導体製造装置	FPD/PV製造装置	電子部品・情報通信機器				
2013:							
売上高							
外部顧客への売上高	\$4,168,283	\$214,354	\$900,213	\$ 4,763	\$5,287,613	\$ —	\$5,287,613
セグメント間の内部売上高又は振替高	457	—	8,644	112,845	121,946	(121,946)	—
計	4,168,740	214,354	908,857	117,608	5,409,559	(121,946)	5,287,613
セグメント利益又は損失	516,746	(67,571)	13,642	14,046	476,863	(287,953)	188,910
セグメント資産	2,381,244	526,199	505,656	16,481	3,429,580	4,816,332	8,254,912
減価償却費	131,101	4,912	4,764	829	141,606	141,552	283,158
のれんの償却額	11,037	—	1,095	—	12,132	—	12,132
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	143,158	17,661	5,125	574	166,518	104,561	271,079

- 注：1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流、施設管理及び保険業務等を含んでおります。
2. (1) 2013年及び2012年3月期のセグメント利益又は損失の調整額、それぞれ27,082百万円(287,953千米ドル)及び34,828百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。2013年及び2012年3月期の全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費で、それぞれ20,359百万円(216,470千米ドル)及び26,071百万円です。
- (2) 2013年及び2012年3月期のセグメント資産の調整額、それぞれ452,976百万円(4,816,332千米ドル)及び451,209百万円の主な内容は、各報告セグメントに配分していない現金及び現金同等物、短期投資、建物及び構築物等です。
3. 2013年3月期の有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額9,834百万円(104,561千米ドル)の主な内容は、各報告セグメントに配分していない建物及び構築物、機械装置・運搬具及び工具器具備品の設備投資額であります。2012年3月期の有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額28,572百万円の主な内容は、各報告セグメントに配分していない建物及び構築物の設備投資額であります。
4. セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の税金等調整前当期純利益と調整を行っております。

## 連結財務諸表注記

## 関連情報

(1) 2013年及び2012年3月期の国内及び海外売上高は、次のとおりであります。

売上高	百万円		千米ドル
	2013	2012	2013
日本	¥118,504	¥171,364	\$1,260,011
米国	117,194	114,951	1,246,082
台湾	107,734	86,882	1,145,497
韓国	59,376	114,218	631,324
その他	94,492	145,676	1,004,699
合計	¥497,300	¥633,091	\$5,287,613

注：売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 2013年及び2012年3月期の地域別有形固定資産残高は、次のとおりであります。

2013:	百万円			
	日本	米国	その他	合計
有形固定資産	¥99,888	¥14,549	¥21,261	¥135,698

2012:	百万円		
	日本	その他	合計
有形固定資産	¥107,874	¥19,011	¥126,885

2013:	千米ドル			
	日本	米国	その他	合計
有形固定資産	\$1,062,073	\$154,694	\$226,061	\$1,442,828

(3) 主要な顧客ごとの情報

売上高合計の10%以上を占める外部顧客への売上高は、次のとおりであります。

顧客の名称又は氏名	関連するセグメント名	百万円	千米ドル
		2013	2013
Intel Corporation	半導体製造装置	¥73,955	\$786,337
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	半導体製造装置	68,769	731,196
Samsung Electronics Co., Ltd.	半導体製造装置、FPD/PV製造装置	60,374	641,935

顧客の名称又は氏名	関連するセグメント名	百万円
		2012
Samsung Electronics Co., Ltd.	半導体製造装置、FPD/PV製造装置	¥116,919
Intel Corporation	半導体製造装置	90,399

注：売上高には、当該顧客と同一の企業集団に属する顧客に対する売上高を含めております。

## 報告セグメントごとののれんに関する情報

報告セグメントごとの2013年3月期ののれんの償却額及び2013年3月31日現在ののれんの未償却残高に関する情報は、次のとおりであります。

2013:	百万円			
	半導体製造装置	FPD/PV製造装置	電子部品・情報通信機器	合計
償却額	¥ 1,038	¥ —	¥103	¥ 1,141
未償却残高	14,565	23,397	411	38,373

2013:	千米ドル			
	半導体製造装置	FPD/PV製造装置	電子部品・情報通信機器	合計
償却額	\$ 11,037	\$ —	\$1,095	\$ 12,132
未償却残高	154,864	248,772	4,370	408,006

## 独立監査人の監査報告書

掲載の連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準並びに我が国の金融商品取引法に準拠した有価証券報告書に記載された連結財務諸表を基礎として作成された英文連結財務諸表を、日本語に翻訳したものです。英文連結財務諸表には英文監査報告書が添付されており、その日本語訳は以下のとおりです。



東京エレクトロン株式会社  
取締役会 御中

私どもは、添付の東京エレクトロン株式会社及び連結子会社の連結財務諸表、すなわち、2013年及び2012年3月31日現在の連結貸借対照表、並びに同日をもって終了する連結会計年度の連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、及び重要な会計方針その他の注記について監査を行った。

### 連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

私どもの責任は、私どもが実施した監査に基づいて、連結財務諸表に対する意見を表明することにある。私どもは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は私どもに、倫理基準等に準拠し、連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私どもの判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私どもは、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査意見

私どもは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京エレクトロン株式会社及び連結子会社の2013年及び2012年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 便宜上の換算

2013年3月31日現在及び同日をもって終了した連結会計年度の連結財務諸表は、読者の便宜のために米国ドルに換算されている。私どもの監査は、日本円で表示されている金額の米国ドルへの換算の検証も含んでおり、私どもは、当該換算が連結財務諸表注記1に記載された方法に準拠しているものと認める。

(KPMG AZSA LLC)

2013年6月21日

日本、東京

連結子会社 (2013年3月31日現在)

株式情報 (2013年3月31日現在)

■ 国内

- 東京エレクトロン山梨株式会社
- 東京エレクトロン九州株式会社
- 東京エレクトロン東北株式会社
- 東京エレクトロン宮城株式会社
- 東京エレクトロンTS株式会社
- 東京エレクトロンFE株式会社
- 東京エレクトロン デバイス株式会社
- 東京エレクトロンBP株式会社
- 東京エレクトロン エージェンシー株式会社

■ 米国

- Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc.
- Tokyo Electron America, Inc.
- TEL Technology Center, America, LLC
- TEL Venture Capital, Inc.
- TEL Epion Inc.
- TEL NEXX, Inc.
- TEL FSI, Inc.

■ 欧州

- Tokyo Electron Europe Limited
- Tokyo Electron Israel Limited
- TEL Magnetic Solutions Limited
- TEL Solar AG

■ アジア

- Tokyo Electron Korea Limited
- Tokyo Electron Taiwan Limited
- Tokyo Electron (Shanghai) Limited
- Tokyo Electron (Kunshan) Limited
- Tokyo Electron Singapore Pte. Limited

上記25社を含め、計58社

社名:

東京エレクトロン株式会社  
〒107-6325  
東京都港区赤坂五丁目3番1号  
赤坂Bizタワー

設立:

1963年11月11日

定時株主総会:

6月

株式の状況:

一単元の株式数	100株
発行可能株式総数	300,000,000株
発行済株式の総数	180,610,911株
株主数	41,287名

上場証券取引所:

東京証券取引所第一部(証券コード:8035)

会計監査人:

有限責任 あずさ監査法人

株主名簿管理人:

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  
三井住友信託銀行株式会社  
(郵便物送付先・電話照会先)  
〒168-0063  
東京都杉並区和泉二丁目8番4号  
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部  
☎0120-782-031 (フリーダイヤル)

お問い合わせ先:

東京エレクトロン株式会社 IR室  
〒107-6325  
東京都港区赤坂五丁目3番1号  
赤坂Bizタワー  
電話: 03-5561-7000

URL:

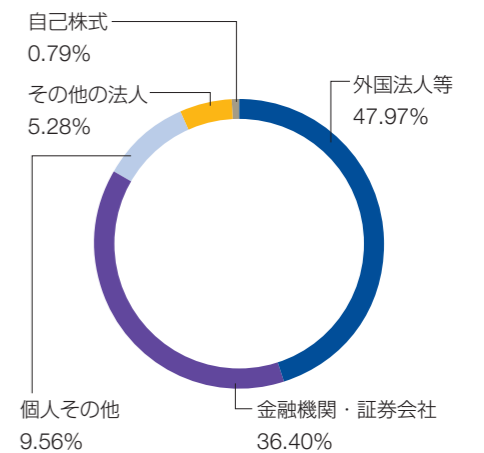
http://www.tel.co.jp/

大株主の状況:

	持株数 (千株)	持株比率 (%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	19,146	10.68
日本トラスティサービス信託銀行株式会社(信託口)	13,824	7.71
株式会社東京放送ホールディングス	7,727	4.31
メロンバンクトリートリー クライアント オムニバス	5,247	2.92
ステート ストリート バンク アンドトラスト カンパニー 505225	4,389	2.44
SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS	3,744	2.08
メロンバンク エヌイー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション	3,623	2.02
ザバンク オブ ニューヨーク-ジャスティックトリートリーアカウント	3,465	1.93
ノーザントラスト カンパニー(エイブイエフシー) サブ アカウント アメリカン クライアント	2,697	1.50
ステート ストリート バンク アンドトラスト カンパニー 505017	2,650	1.47

(注) 1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しています。  
2. 持株比率は、自己株式(1,424,203株)を控除して算出しています。

所有者別状況:



株価・出来高の推移:

